

股票代號：7730

暉盛科技股份有限公司

NANO ELECTRONICS AND MICRO SYSTEM TECHNOLOGIES, INC.

民國一百一十四年度年報



刊印日期:中華民國 115 年 3 月 31 日

本年報查詢網址

公開資訊觀測站:<https://mops.twse.com.tw>

本公司網址:[https:// www.nemstek.com.tw](https://www.nemstek.com.tw)

一、 發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人：邱冠陸

職稱：行銷部經理

電話：(06)291-5500

電子郵件信箱：nems_service@nemstek.com.tw

代理發言人：蔡郁仁

職稱：財會部經理

電話：(06)291-5500

電子郵件信箱：nems_service@nemstek.com.tw

二、 總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：709035 台南市安南區科技五路 100 號

總公司電話：(06)291-5500

三、 股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部

地址：臺北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓

網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

電話：(02)2383-6888

四、 最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

簽證會計師：李國銘會計師、郭怡伶會計師

事務所名稱：國富浩華聯合會計師事務所

地址：高雄市苓雅區四維三路 6 號 27 樓之 1

網址：[https:// www.crowe.tw](https://www.crowe.tw)

電話：(07)331-2133

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、 公司網址：<https://www.nemstek.com.tw>

目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	5
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管	5
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	10
三、公司治理運作情形	14
四、會計師公費資訊	48
五、更換會計師資訊.....	48
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	49
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	50
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	51
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算宗和持股比例.....	51
參、募資情形	52
一、資本及股份.....	52
二、公司債辦理情形	54
三、特別股辦理情形	54
四、海外存託憑證辦理情形	54
五、員工認股權憑證辦理情形	54
六、限制員工權利新股辦理情形.....	54
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	54
八、資金運用計畫執行情形	54
肆、營運概況	56
一、業務內容.....	56
二、市場及產銷概況	68
三、從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	72
四、環保支出資訊	72

五、勞資關係.....	73
六、資通安全管理	73
七、重要契約.....	74
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	75
一、財務狀況.....	75
二、財務績效.....	77
三、現金流量.....	78
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	79
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	79
六、風險事項分析評估	80
七、其他重要事項.....	82
陸、特別記載事項.....	83
一、關係企業相關資料	83
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	84
三、其他必要補充說明事項	84
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	84

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

茲就過去一年之營運狀況報告如下：

一、114 年度營業報告

(一) 營業計畫實施成果

民國 114 年度本公司主要產銷重點，主要為 IC 載板領域電漿去膠渣機與電漿蝕刻機、半導體領域(主要為先進封裝)的電漿清洗機與電漿蝕刻機。

茲將本公司 114 年度營業結果重點說明如下：

單位：新台幣仟元

項目(合併)	113 年	114 年	增(減)金額	變動比例
營業收入	547,630	518,437	(29,193)	-5.33%
營業成本	332,690	285,714	(46,976)	-14.12%
營業毛利	214,940	232,723	17,783	8.27%
營業費用	127,901	158,697	30,796	24.08%
營業利益	87,039	74,026	(13,013)	-14.95%
營業外收(支)	25,944	1,601	(24,343)	-93.83%
稅前淨利	112,983	75,627	(37,356)	-33.06%
稅後淨利	86,950	60,395	(26,555)	-30.54%
綜合損益	87,085	60,359	(26,726)	-30.69%

(二) 預算執行情形

本公司 114 年度僅設定內部預算目標，並未對外公開財務預測數字，整體營收及獲利因產業變化之影響，導致本公司 114 年營收淨額為新台幣 518,437 仟元，稅後淨利為新台幣 60,395 仟元，而 114 年營收預算數為新台幣 706,798 仟元，淨利為 99,912 仟元，114 年度營收達成率僅為 77.48%，淨利達成率僅為 60.42%，淨利達成率偏低的原因係因為消費性電子低迷設備機台收入減少，導致公司獲利達成偏低的主要原因。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項目		113 年	114 年	
財務結構 (%)	負債占資產比率	31.37%	22.98%	
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	338.37%	416.02%	
償債能力 (%)	流動比率	430.15%	537.79%	
	速動比率	390.46%	492.85%	
獲利能力 (%)	資產報酬率	8.19%	5.27%	
	占實收資本比率	營業利益	30.16%	25.65%
		稅前損益	39.15%	20.55%
	權益報酬率	11.89%	7.07%	
基本每股盈餘(元)	\$2.51	\$1.73		

(四) 研究發展狀況

1. 核心研發策略與方向

公司的研發資源採取「戰略集中投放」原則，高度聚焦於高技術門檻與高價值的項目。

- **技術轉型**：115 年定位為由技術深度轉化為規模獲利的轉折年，研發重心從單純技術開發轉向提升生產效能與支持市場拓展。
- **產業聚焦**：以 IC 載板為核心，並將先進封裝視為第二成長動能，特別是針對 AI、HPC（高效能運算）與 5G 需求開發相關製程。
- **資本支出重點**：研發預算優先投入於先進封裝、Hybrid Bonding（混合鍵合）、關鍵客戶 Demo 機、AI 數位轉型及 ESG 減廢技術。

2. 關鍵創新技術與應用

公司在多項尖端製程中建立了強大的技術壁壘。

- **ABF 載板全乾式處理**：領先市場開發以電漿技術取代傳統化學濕製程。其專利的多迴圈式電極感應耦合電漿(ICP)蝕刻設備，能實現奈米級精準蝕刻與高均勻性，顯著提升良率並減少廢液處理成本。
- **先進封裝電漿應用**：
 1. **PLP(面板級封裝)**：用於清潔、蝕刻及層間附著力增強。
 2. **WLP (晶圓級封裝)**：應用於 Underfill (底部填充)、Debond (去膠) 及 RDL (重新布線層) 清潔，支持微縮封裝需求。
 3. **Hybrid Bonding**：開發線路氧化物去除技術，確保銅對銅鍵合界面的潔淨與電氣性能。
 4. **晶圓回收電漿蝕刻**：採用高密度電漿有效去除晶圓表面薄膜，提高控片除膜率，因應 ESG 趨勢下的再生需求。
 5. **壓電材料電漿極化**：專利電漿極化設備採用常壓技術，取代低效耗能的傳統方式，應用於指紋辨識與精密傳感器。
 6. **高溫電漿火炬 (ESG 應用)**：研發高效電漿火焰技術處理固、氣態廢棄物，並研究甲烷裂解製氫，以進入新能源領域。

總結而言，公司的研究發展正緊扣 AI、先進封裝及 ESG 三大產業趨勢，藉由深化關鍵電漿製程的「不可替代性」來建立競爭護城河。

二、115 年度營業計畫概要

本公司將 115 年定位為由「技術深度」轉化為「規模獲利」的關鍵轉折年。年度計畫的核心思維是「由目標到組織，落實於系統」，旨在透過產業聚焦、產品集中與流程效率化，實現獲利槓桿的放大。

以下詳細說明 115 年度營業計畫概要：

(一) 年度經營目標

- ◆ 營收目標：設定為較去年兩位數成長。
- ◆ 經營定位：由過去的「技術導向公司」邁向「可規模化獲利公司」。
- ◆ 營收節奏：預計呈現「前低後高」，**第三季將是全年高峰**，主要受惠於 IC 載板與先進封裝設備的集中交付。

(二)市場判斷與經營策略

公司認為 115 年市場雖具結構性支撐，但存在分化與不確定性。

- 市場機會：AI 與資料中心(HPC) 仍是主要成長動能，帶動先進製程與先進封裝的必要性投資。
- 風險管理：需關注地緣政治、出口管制以及客戶資本支出 (CAPEX) 投資節奏延後等不確定因素。
- 策略地位：避開成熟標準設備的價格戰，聚焦於「最不可替代」的關鍵電漿製程深度，建立技術護城河。

(三)產業聚焦與產品集中

- ✓ 產業分布
 1. IC 載板(核心)：佔營收約 43%-52%，是確保現金流穩定的基石。
 2. 先進封裝 (成長引擎)：佔約 19%-33%，反映在高階製程的擴張。
 3. PCB/軟板(底盤)：提供穩定補充與客戶黏著度。
- ✓ 高價值產品：訂單將集中於高技術門檻的 **ICP-RIE**、**ICP-PE** 及 **MW** 設備，收斂低毛利與低差異化產品。

(四)客戶與通路佈局

- 集團及經營：訂單高度集中於關鍵集團客戶 (前段集團佔比約 80%)，如 日系前幾大載板廠、歐系載板廠、台灣各大載板廠等。
- 通路結構：115 年訂單主要來自「直售代理」、「直售交易」以及仲介銷售。

透過上述策略，公司計畫在 2026 年實現營收兩位數成長，並藉由優化成本結構與產能效率，推升獲利表現。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

根據提供的來源資料，本公司在營運上受到外部競爭、法規及總體經營環境的顯著影響。以下為詳細分析：

(一)外部競爭環境之影響

公司面臨來自國內外大廠的激烈競爭，市場特性與對手動態直接影響其策略佈局。

- ◆ 同業競爭強度高：

公司的競爭對手包括大型整合型設備 (如志聖)、先進封裝成熟方案商 (如鈦昇) 及電漿專注型對手 (如凌嘉、友威科)。區域競爭者常採取削價競爭，對成熟機台的獲利空間造成壓力。
- ◆ 技術變革快速：

AI、高效能運算 (HPC)、Chiplet 及 **Hybrid Bonding** 等技術更新極快，若不能及時跟進，產品可能面臨被淘汰的風險。
- ◆ 客戶議價能力強：

半導體客戶高度集中，對設備的價格與交期極為敏感。
- ◆ 因應策略：

公司選擇避開低毛利的標準化設備競爭，轉向「製程即服務」，專注於高技術門檻的關鍵電漿製程深度 (如 ABF 全乾式製程)，建立「最不可替代」的護城河。

(二)法規環境之影響

法規環境的變化主要體現在環保標準與出口管制兩大面向。

- ESG 與綠色製成浪潮：歐盟與美國的 ESG 要求日益趨嚴，半導體產業面臨低碳轉型壓力。這對公司是機會也是挑戰：其全乾式電漿製程可取代高污染的傳統濕製程，滿足綠色製造需求，成為進入 TSMC、Intel 等大廠供應鏈的關鍵。
- 地緣政治與出口管制：美國對中國的出口管制收緊，影響了半導體設備、材料與技術的流向，直接限制了對特定市場的銷售。
- 智財權保護：專利佈局成為關鍵競爭工具，用以阻擋新進競爭者並提升市場進入門檻。
- 上市合規要求：掛牌上市後，公司需符合更高標準的財報揭露、ESG 資訊披露及公司治理合規要求。

(三)總體經營環境之影響

總體環境的變動性增加，導致市場需求與營運成本具備高度不確定性。

- 地緣政治風險：美中科技戰導致半導體供應鏈重組，迫使客戶投資策略趨於保守，專案評估與決策時間因此拉長。
- 產業景氣循環：半導體產業具有高度週期性波動。當市場需求下降時，客戶會縮減資本支出 (CapEx)，導致設備訂單延後或分期化，營收認列時點隨之後移。
- 供應鏈不確定性：戰爭、台海局勢或極端氣候可能導致原材料（如關鍵氣體、半導體零組件）短缺或價格波動，進而影響設備交付時程與成本控制。
- 匯率變動風險：公司的外銷占比達五成以上且以美元交易為主，但採購則以台幣計價。當台幣相對於美元升值時，會直接減少毛利與稅前淨利。

所以，公司在面對這些環境挑戰時，採取了市場多元化策略（擴展美國、東南亞、歐洲市場以降低對中依賴）以及技術領先戰略（鎖定 AI 與先進封裝必要性投資），試圖在不確定的總體環境中尋求結構性的成長機會。

祝各位股東身體健康、萬事如意。
謝謝！

董事長：宋俊毅



總經理：許嘉元



會計主管：蔡郁仁



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

(一) 董事

附表一

1. 董事資料

115年3月31日；單位：股，%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	宋俊毅	男 61~70歲	112.05.30	3	91.05.27	1,581,973	6.03	3,769,197	10.24	368,769	1.00	-	-	國立臺灣科技大學電子系基丞科技(股)公司總經理	昆山金暉盛電子商貿有限公司董事長	-	-	-	-
董事	中華民國	基丞科技(股)公司	-	112.05.30	3	91.05.27	4,617,756	17.59	5,235,307	14.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	代表人: 江少杰	男 61~70歲	112.05.30	3	91.05.27	-	-	-	-	-	-	-	-	內湖高工機械科	新群科技(股)公司董事長 新杰科技(股)公司董事長 基丞科技(股)公司董事長	-	-	-	-
董事	中華民國	曾坤燦	男 71~80歲	112.05.30	3	91.05.27	1,522,235	5.80	2,519,082	6.85	-	-	-	-	正修科大電子工程學系 江陰新杰科技有限公司總經理 江陰新基電子設備有限公司總經理 基丞科技(股)公司副總經理	-	-	-	-	-
董事	中華民國	許嘉元	男 51~60歲	112.05.30	3	91.05.27	1,089,650	4.15	1,517,980	4.13	27,600	0.08	-	-	成功大學化學工程學系研究所博士	本公司總經理	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	顏盟峯	男 51~60歲	113.01.26	3	113.01.26	-	-	-	-	-	-	-	-	英國雷汀大學財務金融博士 中華郵政股份有限公司外部專家董事 國立成功大學會計學系系主任兼財務金融研究所所長 國立成功大學會計學系兼財務金融研究所副教授	國立成功大學會計學系兼財務金融研究所教授 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院董事 申豐特用應材股份有限公司獨立董事	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	黃蕙玲	女 51~60歲	113.01.26	3	113.01.26	-	-	-	-	-	-	-	-	高雄第一科技大學財務管理系碩士 元山科技(股)公司總管理處處長兼財務長 寶來證券(股)公司資深經理 台新證券(股)公司資深協理 綠需能源(股)公司財務長	怡和國際能源(股)公司財會處長 綠盛能源工程(股)公司監察人 綠盛一能源工程(股)公司監察人 怡和綠能(股)公司監察人 昱豐事業(股)公司董事 利豐能源(股)公司董事 城七能源(股)公司董事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	何志文	男 61~70歲	113.01.26	3	113.01.26	-	-	-	-	-	-	-	-	國立臺灣大學機械工程研究所材料組碩士 飛信半導體(股)公司副總經理、總經理	-	-	-	-	

2.法人股東之主要股東

115年3月31日；單位：股，%

法人股東名稱	法人股東之主要股東
基丞科技(股)公司	江少杰 33.46%、李欽全 6.25%、江明奇 5.65%、江明源 5.65%、常菁菁 4.55%、曾坤燦 3.52%、葉卉妍 2.94%、陳仕舫 2.73%、陳傳男 2.73%、宋俊毅 2.70%

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東：不適用

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
宋俊毅		相關學經歷請詳董事資料，具豐富之商務、企業經營管理經驗，未有公司法第30條各款情事。	未與其他董事間具配偶或二親等以內親屬關係，以及無證券交易法第二十六條之三第三項及第四項規定情事。	-
基丞科技(股)公司 代表人:江少杰		相關學經歷請詳董事資料，具豐富之半導體、自動化產業、企業經營管理經驗，未有公司法第30條各款情事。		-
曾坤燦		相關學經歷請詳董事資料，具豐富之商務、企業經營管理經驗，未有公司法第30條各款情事。		-
許嘉元		相關學經歷請詳董事資料，具豐富之商務、企業經營管理經驗，未有公司法第30條各款情事。		-
顏盟峯		相關學經歷請詳董事資料，具豐富之商務、企業財務金融經驗，未有公司法第30條各款情事。	(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9)(10) (11)(12)	1
黃蕙玲		相關學經歷請詳董事資料，具豐富之商務、企業財務金融經驗，未有公司法第30條各款情事。	(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9)(10) (11)(12)	-
何志文		相關學經歷請詳董事資料，具豐富之半導體、企業經營管理經驗，未有公司法第30條各款情事。	(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9)(10) (11)(12)	-

註：董事於選任前二年及任職期間之獨立性情形。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

5.董事會多元化及獨立性

(1)本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形

姓名	多元化 核心	基本組成					獨董 任期	具備之能力								
		國 籍	性 別	具有 員工 身分	年齡			營 運 判 斷 力	會 計 及 財 務 分 析 能 力	危 機 處 理 能 力	經 營 管 理 能 力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力	
					51-60	61-70										71-80
宋俊毅	中華民國	男			✓		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
基丞科技(股)公司 代表人：江少杰	中華民國	男				✓	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
曾坤燦	中華民國	男				✓	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
許嘉元	中華民國	男	✓	✓			-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
顏盟峯	中華民國	男		✓			第一屆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃蕙玲	中華民國	女		✓			第一屆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
何志文	中華民國	男			✓		第一屆	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

現任董事成員來自不同專業領域，可於董事會提供多元意見。本公司現任董事會由 7 位董事組成(包含 3 位獨立董事)，成員具備財金、商務、化學工程及管理領域之豐富經驗與專業，董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於本公司董事會整體應具備能力之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事年齡分布情形：71 至 80 歲者有 2 位、70 歲以下者有 5 位；此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目前已達 14%，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

(2)董事會多元化政策之具體管理目標達成情形

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	已達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
獨立董事任期未逾 3 屆	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成

(3)若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：不適用。

(4)董事會獨立性

董事會獨立性請參閱本年報前列董事資料及董事專業資格資訊揭露及獨立性資訊揭露。由前述董事資料表格可知董事間均未具有配偶或二親等以內之親屬關係，故無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項之情事。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

附表一之一

115年3月31日；單位：股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
總經理	許嘉元	男	中華民國	91.06.11	1,517,980	4.13	27,600	0.08	-	-	成功大學化學工程學系研究所博士	-	-	-	註1	-	
生產部 部經理	符永豪	男	馬來西亞	91.06.11	320,000	0.87	1,185,697	3.22	-	-	成功大學資源工程系研究所碩士 鈦昇科技(股)公司研發工程師	-	-	-	註1	-	
行銷部 部經理	邱冠陸	男	中華民國	91.08.14	1,295,000	3.52	-	-	-	-	成功大學航太研究所碩士 成大嚴慶齡中心專案經理	-	-	-	註1	-	
研發部 資深經理	梁國超	男	中華民國	108.06.03	295,003	0.80	-	-	-	-	成功大學化學工程學系研究所博士 核能研究所副研員	-	-	-	註1	-	
客服部 經理	劉一儒	女	中華民國	114.02.01	19,700	0.05	6,560	0.02	-	-	南台科技大學休閒事業管理系	-	-	-	註1	-	
財會部經 理兼公司 治理主管	蔡郁仁	男	中華民國	111.12.22	136,720	0.36	-	-	-	-	政治大學會計系研究所碩士 阜奕管理顧問(股)公司財務協理	-	-	-	註1	-	
稽核主管	曾雅綉	女	中華民國	111.12.22	10,000	0.03	-	-	-	-	淡江大學會計系 國泰綜合證券(股)公司業務經理 勤業眾信聯合會計師事務所副理	-	-	-	註1	-	

註1：上表資料以115年3月23日停止過戶之股東名冊為準。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

附表一之二(1-2-1)

(一) 最近年度(114 年度)支付董事及獨立董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例(%)	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金							
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞 (G)										
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司				財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司			
現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額					
董事長	宋俊毅																									
董事	基丞科技(股)公司 代表人: 江少杰																									
董事	曾坤燦	6,678	6,678	-	-	1,806	1,806	-	-	8,484	14.05%	8,484	14.05%	4,613	4,613	108	108	656	-	656	-	13,861	22.95%	13,861	22.95%	-
董事	許嘉元																									
獨立董事	顏盟峯																									
獨立董事	黃蕙玲																									
獨立董事	何志文																									
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：不適用。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																										

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
低於 1,000,000 元	基丞科技(股)公司代表人江少杰、曾坤燦、顏盟峯、黃蕙玲、何志文	基丞科技(股)公司代表人江少杰、曾坤燦、顏盟峯、黃蕙玲、何志文	基丞科技(股)公司代表人江少杰、曾坤燦、顏盟峯、黃蕙玲、何志文	基丞科技(股)公司代表人江少杰、曾坤燦、顏盟峯、黃蕙玲、何志文
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	宋俊毅、許嘉元	宋俊毅、許嘉元	宋俊毅、許嘉元	宋俊毅、許嘉元
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	7 人	7 人	7 人	7 人

附表一之二(3-1)

(二) 最近年度(114 年度)支付總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	許嘉元	2,653	2,653	108	108	1,960	1,960	656	-	656	-	5,377 8.90%	5,377 8.90%	-

酬金級距表

附表一之二(3-2-2)

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司 E
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	許嘉元	許嘉元
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	1 人	1 人

(三) 上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金：不適用。

(四) 最近年度(114 年度)支付監察人之酬金：不適用。

附表一之三

(五) 最近年度(114 年度)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	許嘉元	-	1,925 (註 1)	1,925	3.19%
	生產部 部經理	符永豪				
	行銷部 部經理	邱冠陸				
	財會部 經理	蔡郁仁				

註 1：係按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

(六) 酬金給付相關性影響之說明

分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1.本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元

年度	113 年度				114 年度			
	酬金總額		總額占稅後純益比例(%)		酬金總額		總額占稅後純益比例(%)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	8,278	8,278	9.52	9.52	8,484	8,484	14.05	14.05
監察人	-	-	-	-	-	-	-	-
執行長(註 1)及總經理	6,562	6,562	7.55	7.55	5,377	5,377	8.90	8.90

註 1：宋俊毅 112/10/31 辭任執行長一職，專任董事長。

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事、監察人酬勞已明訂於公司章程內；執行長及總經理之酬金包含薪資、獎金及員工紅利，係依所擔任之職位、所承擔之責任與對公司之貢獻程度，並參酌同業水準議定之；訂定酬金之程序，係依據公司章程及核決權限訂定之。本公司 113 年及 114 年依照「董事及經理人薪資酬勞辦法」發放董事、監察人之酬勞，本公司支付執行長及總經理酬金，已併同考量公司未來面臨之營運風險及其與經營績效之正向關聯性，以謀永續經營風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

最近年度及截至年報刊印日止，董事會開會 10(A)次，董事及獨立董事出席情形

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/A)	備註
董事長	宋俊毅	10	-	100	
董事	曾坤燦	8	2	80	
董事	許嘉元	10	-	100	
董事	基丞科技(股)公司 代表人江少杰	5	5	50	
獨立董事	顏盟峯	9	1	90	
獨立董事	黃蕙玲	10	-	100	
獨立董事	何志文	9	1	90	

其他應記載事項

1.董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項

日期	屆次	重要決議	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
114 年 3 月 19 日	第 8 屆第 12 次	<ul style="list-style-type: none"> •本公司 113 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 •通過本公司 113 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 •本公司 113 年度盈餘分配案。 •訂定本公司基層員工範圍案。 •本公司「公司章程」修訂案。 •本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明」案。 •本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修訂案。 •本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含董事長 114 年度薪資報酬)案。 •本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含經理人 114 年度薪資報酬)案。 •訂定召開本公司一一四年股東常會召集事由。 •永豐銀行額度展期案。 	無	無
114 年 5 月 13 日	第 8 屆第 13 次	<ul style="list-style-type: none"> •本公司 114 年度第一季合併財務報表案。 •本公司 113 年度董監事酬勞分派金額案。 •本公司經理人 113 年度第一次員工酬勞分派金額案。 •檢討本公司「薪資酬勞委員會組織規程」及「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 	無	無
114 年 6 月 11 日	第 8 屆第 14 次	<ul style="list-style-type: none"> •本公司審請股票創新板上市案。 •本公司財務報告編製能力評估案。 •本公司 114 年第二季及第三季財務預測案。 •本公司公司治理評鑑自評案。 •本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 •本公司 113 年 10 月 1 日至 114 年 03 月 31 日內部控制制度聲明書討論案。 •本公司修訂薪工循環內部控制案。 	無	無
114 年 7 月 9 日	第 8 屆第 15 次	<ul style="list-style-type: none"> •本公司授權董事長訂定配股增資基準日、配息基準日及發放日案。 	無	無
114 年 7 月 11 日	第 8 屆第 16 次	<ul style="list-style-type: none"> •本公司 114 年第一季合併財務報表修改案。 	無	無
114 年 8 月 8 日	第 8 屆第 17 次	<ul style="list-style-type: none"> •本公司 114 年第二季合併財務報表案。 •元大銀行額度展期案。 	無	無
114 年 9 月 5 日	第 8 屆第 18 次	<ul style="list-style-type: none"> •本公司擬辦理初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案。 	無	無

		<ul style="list-style-type: none"> •本公司擬通過自上市掛牌起三個會計年度委任主辦承銷商之保薦契約案。 •訂定現金增資員工認股辦法。 •本公司現金增資員工認股案。 •本公司經理人 113 年度第二次員工酬勞分派金額案。 		
114 年 11 月 5 日	第 8 屆 第 19 次	<ul style="list-style-type: none"> •本公司 114 年第三季合併財務報表案。 	無	無
114 年 12 月 24 日	第 8 屆 第 20 次	<ul style="list-style-type: none"> •本公司 115 年度營運計劃及預算案。 •本公司 115 年度稽核計畫案。 •本公司 114 年度至 116 年度內部控制制度專案審查委任案。 •本公司經理人 113 年度第三次員工酬勞及 114 年度年終獎金個人分派金額案。 •本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估、委任報酬暨民國 115 年預先核准之非確信服務清單案。 	無	無
115 年 3 月 4 日	第 8 屆 第 21 次	<ul style="list-style-type: none"> •本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 •本公司基層員工範圍定期評估案。 •本公司 114 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 •本公司 114 年度盈餘分配案。 •本公司盈餘轉增資發行新股案。 •本公司「公司章程」修訂案。 •增訂本公司「內部稽核人員之任免、考核、薪資報酬辦法」案。 •本公司 114 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 •本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含董事長 115 年度薪資報酬)案。 •本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含經理人 115 年度薪資報酬)案。 •本公司全面改選董事案。 •本公司提名並決議董事暨獨立董事候選人案。 •本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 •訂定召開本公司一一五年股東常會召集事由。 •永豐銀行額度展期案。 	無	無

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會決議事項：
無此情形。

2.本公司 114 年度董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形

(1) 114 年 03 月 19 日本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含董事長 114 年度薪資報酬)案，因董事長宋俊毅、獨董顏盟峯、獨董黃蕙玲、獨董何志文為本次薪資報

酬分派成員，涉及薪資報酬分派金額，依法已主動分別輪流利益迴避未參與表決外，經餘出席董事無異議照案通過。本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含經理人114年度薪資報酬)案，因董事許嘉元兼任本公司總經理一職，涉及許嘉元總經理薪資報酬，依法利益迴避未參與表決外，經餘出席董事無異議照案通過。

- (2)114年5月13日本公司113年度董監事酬勞分派金額案，因董事長宋俊毅、董事許嘉元、董事曾坤燦、董事江少杰為本次董監酬勞分派成員，涉及董監酬勞分派金額，有自身利害關係之虞，依法利益迴避未參與表決外，並由董事長指定董顏盟峯暫代主席，徵詢其他出席董事，無異議照案通過。114年5月13日本公司經理人113年度第一次員工酬勞分派金額案，因董事許嘉元兼任本公司總經理一職，涉及許嘉元總經理薪資報酬，依法利益迴避未參與表決外，經餘出席董事無異議照案通過。
- (3)114年9月5日本公司經理人113年度第二次員工酬勞分派金額案，因董事許嘉元兼任本公司總經理一職，涉及許嘉元總經理薪資報酬，依法利益迴避未參與表決外，經餘出席董事無異議照案通過。
- (4)114年12月24日本公司經理人113年度第三次員工酬勞分派金額案，因董事許嘉元兼任本公司總經理一職，涉及許嘉元總經理薪資報酬，依法利益迴避未參與表決外，經餘出席董事無異議照案通過。
- (5)115年03月4日本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含董事長115年度薪資報酬)案，因董事長宋俊毅、獨董顏盟峯、獨董黃蕙玲、獨董何志文為本次薪資報酬分派成員，涉及薪資報酬分派金額，依法已主動分別輪流利益迴避未參與表決外，經餘出席董事無異議照案通過。本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含經理人115年度薪資報酬)案，因董事許嘉元兼任本公司總經理一職，涉及許嘉元總經理薪資報酬，依法利益迴避未參與表決外，經餘出席董事無異議照案通過。

3.上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
1次/年	114/1/1 ~ 114/12/31	1.董事會 2.個別董事成員 3.審計委員會 4.薪資報酬委員會	1.董事會內部自評 2.董事成員自評 3.委員會成員自評	1.董事會績效評估： (1)對公司營運之參與程度 (2)提升董事會決策品質 (3)董事會組成與結構 (4)董事之選任及持續進修 (5)內部控制。 2.個別董事成員績效評估： (1)公司目標與任務之掌握 (2)董事職責認知 (3)對公司營運之參與程度 (4)內部關係經營與溝通 (5)董事之專業及持續進修 (6)內部控制。 3.功能性委員會績效評估： (1)對公司營運之參與程度 (2)功能性委員會職責認知 (3)功能性委員會決策品質 (4)功能性委員會組成及成員選任

				(5)內部控制。
自行評估結果已上傳公司網站，請參閱。				

4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估

加強董事會職能目標	執行情形評估
1.健全本公司監督功能及強化管理機制	本公司已於 112/12/27 設置薪資報酬委員會，113/1/26 設置審計委員會。
2.持續提升資訊透明度	本公司指定專人依法令規定負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新。
3.積極建立與利害關係者之溝通	1.本公司設有發言人及代理發言人，利害關係人可藉此當作溝通管道，或至本公司網站之利害關係人專區，線上提問及建議。 2.每年股東會依時程受理股東提案，有提案權之股東可於受理期間向公司提出申請，本公司將依規定召開董事會審查之。
4.加強專業知識	本公司所有董事於 114 年度皆完成法定要求之進修時數，並持續安排多元外部進修課程，增強其專業性。
5.購買董事及經理人責任保險	本公司已於 115 年 2 月 1 日加保董事及經理人責任保險，並提報 115 年 3 月 4 日董事會。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1. 審計委員會運作情形

(1) 本公司於 113 年 1 月 26 日股東臨時會補選 3 席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

(2) 最近年度(114)及截至年報刊印日止審計委員會開會 9 次(A)，獨立董事出席情形

附表二之一

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/A)	備註
審計委員	顏盟峯	8	1	88.89	
審計委員	黃蕙玲	9	-	100	
審計委員	何志文	8	1	88.89	
其他應記載事項：					
<p>1. 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。</p> <p>每年獨立董事與內部稽核主管及會計師均會透過會議進行溝通，溝通日期、性質與主題如下表，溝通過程均無異議。</p> <p>(1)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。</p>					
日期	屆次	重要決議		審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114 年 3 月 19 日	第 1 屆 第 5 次	1.通過本公司 113 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 2.本公司 113 年度盈餘分配。 3.本公司盈餘轉增資發行新股案。 4.本公司「公司章程」修訂案。 5.本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。		本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無
114 年 5 月 13 日	第 1 屆 第 6 次	1.本公司 114 年第一季合併財務報表案。		本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無
114 年 6 月 11 日	第 1 屆 第 7 次	1.本公司申請股票創新板上市案。 2.本公司財務報告編制能力評估案。 3.本公司 114 年度第二季及第三季財務預測案。 4.本公司公司治理評鑑自評案。 5.本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 6.本公司 113 年 10 月 1 日至 114 年 03 月 31 日內部控制制度聲明書討論案。 7.本公司修訂薪工循環內控制度案。		本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無
114 年 7 月 11 日	第 1 屆 第 8 次	1.本公司 114 年度第一季合併財務報表修改案。		本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無

114年 8月8日	第1屆 第9次	1.本公司114年度第二季合併財務報表案。 2.元大銀行額度展期案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無
114年 9月5日	第1屆 第10次	1.本公司擬辦理初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案。 2.本公司擬通過自上市掛牌起三個會計年度委任主辦承銷商之保薦契約案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無
114年 11月5日	第1屆 第11次	1.本公司114年度第三季合併財務報表案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無
114年 12月24日	第1屆 第12次	1.本公司115年度營運計劃及預算案。 2.本公司115年度稽核計畫案。 3.本公司114年度至116年度內部控制制度專案審查委任案。 4.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估、委任報酬暨民國115年預先核准之非確信服務清單案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無
115年 3月4日	第1屆 第5次	1.通過本公司113年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 2.本公司113年度盈餘分配案。 3.本公司盈餘轉增資發行新股案。 4.本公司「公司章程」修訂案。 5.本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無

(2)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

(1)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

A.本公司內部稽核主管除至少每季一次將稽核報告及查核缺失、改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管於審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明，依其指示加強稽核工作內容，確保內部控制制度的有效性，並與獨立董事溝通情形良好。

B.稽核主管與獨立董事得視需要以電子郵件、電話或當面方式等直接聯繫，溝通管道暢通。

(2)獨立董事與會計師之溝通情形

A.本公司簽證會計師每年至少一次，針對當季及年度本公司及海外子公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs 公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響列方式充分溝通。

B.會計師與獨立董事得於審計委員會或視需要以電子郵件、電話或當面方式等進行溝通。

2.監察人參與董事會運作情形：不適用

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司訂有公司治理實務守則，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度等皆有相關規範，有關公司公司治理實務守則，請至本公司官網查詢。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V V V V		(一)本公司除委託專職股務代理機構處理股東相關事務外，並訂定「內部重大資訊處理作業程序」，並設有專責人員處理股東建議或糾紛。 (二)本公司已委由股務代理機構負責，能隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依規定按月申報董事、經理人及持股百分之十以上大股東之持股異動情形。 (三)本公司已訂定「關係人、特定公司及集團企業相互間財務業務相關作業規範」、「對子公司之監督及管理辦法」及「取得或處分資產處理程序」等內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆。 (四)本公司已訂定「內線交易防制辦法」及控制重點，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，以防範內線交易之發生。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標落實執行？ (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評	V V V		(一)本公司業已訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，就董事會成員擬定多元化方針並落實執行本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事7位包含1位女性董事，比率達14.28%。 (二)本公司已設立審計委員會及薪資報酬委員會，其他功能性委員會未來將視需要評估設置。 (三)本公司業已訂定「董事會績效評估辦法」於每年定期進行績效評估並依辦法評估董事績效之項目衡量，包含以下面向： 1.對公司營運之參與程度	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制</p> <p>(四)本公司每年定期由董事會評估簽證會計師之獨立性。本公司董事會於討論簽證會計師聘任及獨立性時，須檢具會計師個人簡歷及獨立性聲明(未違反職業道德規範公報第十號)以供董事會評估其獨立性之討論。本公司113年12月25日董事會審議通過簽證會計師皆符合本公司獨立性評估標準。本公司亦有參考國富浩華聯合會計師事務所所提供之審計品質指標(AQIs)五大構面評估其審計品質與獨立性。</p>	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		<p>本公司於113年12月25日董事會委任通過財會部蔡郁仁經理負責公司治理相關事務之最高主管，推動公司治理並有效發揮董事會職能，職權範圍及當年度業務執行重點如下：</p> <p>1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2.製作董事會及股東會議事錄。 3.協助董事持續進修。 4.提供董事執行業務所需之資料。 5.協助董事遵循法令。</p>	無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		<p>本公司官網設置利害關係人專區並留有利害關係人聯絡方式，以回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。</p>	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		<p>本公司委任專業股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會事務。</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>七、資訊公開</p> <p>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？</p> <p>(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>	V	V	<p>(一)本公司官網已揭露財務業務及公司治理資訊。</p> <p>(二)本公司落實發言人制度，並依資訊揭露規定將公司營運資訊公開，且已架設英文網站，股東會相關資訊均定時於公司網站更新。</p> <p>(三)本公司已於規定期限前公告並申報財務報告與各月營運情形。未來將視公司營運情形及相關法令規定提前公告並申報年度財務報告。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>均依法規期限內公告，並已逐步提前公告</p>
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？</p>	V		<p>1.員工權益： 本公司對員工權益除依勞基法及相關法令辦理，設立職工福利委員會，依法提撥職工福利金及員工退休金。</p> <p>2.僱員關懷： 公司定期實施員工健康檢查及提供醫療諮詢，以維護員工身心健康，並持續改善員工工作環境皆能滿足國際性規範之需求。故所有員工均能依其意願達成與公司約定之工作，不礙生理或心理之脅迫，並且不因任何種族、性別、年齡、宗教或政治傾向受到歧視。</p> <p>3.投資者關係： 設有股務單位及發言人，負責處理相關股務事宜及股東建議及糾紛等問題。</p> <p>4.供應商關係： 本公司與供應商維持平等及良好之關係。</p> <p>5.利害關係人之權利： 本公司設有發言人，利害關係人如有需求除可透過公司專屬窗口聯繫外，亦可藉由本公司網頁登載之公司聯絡資訊，隨時與本公司聯絡，以維護利害關係人之權益。</p> <p>6.董事及監察人之進修情形： 本公司董事均具備相關專業知識並依法令規定每年持續進修相關之課程時數。</p>	<p>無重大差異。</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 目前本公司內部控制風險管理制度及重要管理規章辦法之制修訂都須經由董事會核決。 8.客戶政策之執行情形： 本公司與客戶維持良好之關係。 9.公司為董事購買責任保險之情形： 本公司業已為董事購買責任保險，以配合公司治理強化股東權益之保障。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：不適用。				

114 年度董事進修情況

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	宋俊毅	114/6/11	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	妥適安排家族企業之傳承接班及法律風險探討	3
董事	基丞科技(股)公司 代表人:江少杰	114/6/11	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	妥適安排家族企業之傳承接班及法律風險探討	3
董事	曾坤燦	114/6/11	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	妥適安排家族企業之傳承接班及法律風險探討	3
董事	許嘉元	114/6/11	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	妥適安排家族企業之傳承接班及法律風險探討	3
獨立董事	顏盟峯	114/6/11	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	妥適安排家族企業之傳承接班及法律風險探討	3
獨立董事	黃蕙玲	114/6/11	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	妥適安排家族企業之傳承接班及法律風險探討	3
獨立董事	何志文	114/6/11	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	妥適安排家族企業之傳承接班及法律風險探討	3
董事長	宋俊毅	114/11/5	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	從法令與治理角度看企業之 AI 應用、創新	3
董事	基丞科技(股)公司 代表人:江少杰	114/11/5	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	從法令與治理角度看企業之 AI 應用、創新	3
董事	曾坤燦	114/11/5	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	從法令與治理角度看企業之 AI 應用、創新	3
董事	許嘉元	114/11/5	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	從法令與治理角度看企業之 AI 應用、創新	3
獨立董事	顏盟峯	114/11/5	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	從法令與治理角度看企業之 AI 應用、創新	3
獨立董事	黃蕙玲	114/11/5	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	從法令與治理角度看企業之 AI 應用、創新	3
獨立董事	何志文	114/11/5	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	從法令與治理角度看企業之 AI 應用、創新	3

(四) 薪資報酬委員會其組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

115年3月31日

身分別	姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 (召集人)	顏盟峯	請參閱本年報，董事 專業資格及獨立性資 訊揭露	請參閱前列董 事專業資格及 獨立董事獨立 資訊揭露	1
獨立董事	黃蕙玲	請參閱本年報，董事 專業資格及獨立性資 訊揭露		-
獨立董事	何志文	請參閱本年報，董事 專業資格及獨立性資 訊揭露		-

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會計3人。

(2) 本屆委員任期：112年12月27日至115年05月29日，最近年度(114)及截至
年報刊印日止薪資報酬委員會開會5(A)次，委員資格及出席情形

職稱	姓名	實際出席次 數(B)	委託出席次 數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	顏盟峯	5	0	100	
委員	黃蕙玲	5	0	100	
委員	何志文	4	1	80	
<p>其他應記載事項</p> <p>一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。</p> <p>二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。</p>					

(3) 最近年度及截至年報刊印日止薪資報酬委員會重要決議事項

日期	屆次	重要決議	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114年 3月19日	第1屆 第5次	1.本公司113年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 2.本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含董事長114年度薪資報酬)案。 3.本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含經理人114年度薪資報酬)案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無
114年 5月13日	第1屆 第6次	1.本公司113年度董監事酬勞分派金額案。 2.本公司經理人113年度第一次員工酬勞分派金額案。 3.檢討本公司「薪資酬勞委員會組織規程」及「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無
114年 9月05日	第1屆 第7次	1.訂定現金增資員工認股辦法案。 2.本公司現金增資員工認股案。 3.本公司經理人113年度第二次員工酬勞分派金額案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無
114年 12月24日	第1屆 第8次	1.本公司經理人113年度第三次員工酬勞及114年度年終獎金個人分派金額案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無
115年 3月4日	第1屆 第9次	1.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司基層員工範圍定期評估案。 3.本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含董事長115年度薪資報酬)案。 4.本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(含經理人115年度薪資報酬)案。	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。	無

(五) 推動永續發展執行情形與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因

評估架構	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一.公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司訂有「永續發展實務守則」，由董事會不定期會審視公司治理內容，並推動企業社會責任觀念。	無重大差異
二.公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司已訂定「永續發展實務守則」，追求永續經營與獲利之同時，亦重視環境保護、社會責任與公司治理之平衡，將其納入公司管理方針與日常營運活動中，積極參與推動社會公益、加強企業社會責任資訊揭露。	無重大差異
三.環境議題 1.公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司之產業特性並無環境污染問題。	
2.公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司除設有資源分類回收筒，亦努力宣導資源回收之社會責任。 本公司投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備，並揭露投資金額及設備項目，以及節能或減碳之量化數據。 1. 節能設備：99.99kWp(峰瓦)太陽能光電設備 2. 投資金額：3,660,000 元(新台幣) 3. 實際節能數據：114 年度實際發電 102,413 度， 102,413 度* 0.474 公斤 CO ₂ e/度 碳排量=減量約 49 噸 CO ₂ 。	無重大差異
3.公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		本公司將全力支持政府所提倡之各項節能減碳之環保政策，並密切注意氣候變遷對營運活動之影響。	

評估架構	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
4.公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管之政策？		V	本公司積極配合政府提倡之各項節能減碳環保政策，持續進行無紙化作業之推動，降低年度用紙量。	無重大差異
四.社會議題 1.公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司認同並自願遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準，並遵循勞動法規，由專責單位人資部門訂定工作規則等相關人事規範，確保公司內部同仁之合法人權權益。	無重大差異
2.公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等）並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作，辦理各項福利事項；本公司酬金政策，係依據個人能力，對公司的貢獻度、績效表現，與經營績效之關聯性成正相關。此外，依本公司董事會已通過修改章程如下「本公司年度如有獲利，應依下列比率提撥員工酬勞：百分之二~十，前述員工酬勞總額中不低於百分之四十五應提撥為分派予基層員工之酬勞。」，適當將公司經營績效或成果反映於員工薪酬。本公司並重視職場多元化與平等，落實男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，女性主管職占比 25%，另也進用身障同仁人數並符合法規標準，提供身障同仁友善的工作職務及環境設施。	
3.公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		本公司依照規定，於有安全或職災疑慮之環境或設施，加以警示或配發防護器材，本公司全體員工每三年一次必須接受一般職安教育訓練，以提升員工安全意識、預防災害發生，並一年一次辦理員工健康檢查，建築物公共安全檢查二年一次，消防安全設備檢查二年一次。114.11.28進行全體員工消防安全宣導，本公司本年度員工職災及火災件數皆為零。	

評估架構	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
4.公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		本公司由各單位針對員工的專業及能力規劃與執行職涯培育發展計畫。	
5. 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		本公司所提供之產品屬客製化產品，故對於客戶要求之規格及製作條件皆按照合約內容執行並且保密。本公司訂有「個人資料保護管理辦法」，落實客戶個人資料之保護、管理及利用，另遵照保密合約之協議保護交易資訊不外洩。如有客訴事件，本公司官網有「利害關係人」及「聯絡我們」專區，提供公司服務電話跟意見箱，服務不漏接。	
6.公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		本公司訂有「供應商及代工廠商管理作業」及「供應商企業社會責任管理辦法」，規範供應商在環境保護及安全衛生之要求，增進對社會與環境之責任，與供應商共同致力於綠色環保科技，且每年度定期進行供應商評鑑。	本公司無評估供應商過去有無影響環境與社會。
五.公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		√	本公司未來將依照國際通用之報告書編製準則標準並遵循「新版公司治理藍圖」相關期程編制永續報告書。	本公司並未編製永續報告書，但配合法令逐步實施。
六.公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有「永續發展實務守則」，其運作與守則差異情形如上所述。				

評估架構	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
七.其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
1.回饋社會 暉盛秉持回饋社會的精神，定期舉辦關懷低收入戶公益活動，提供生活物資，協助家庭度過困境，活動由同仁共同參與，傳遞企業關懷與溫暖。公司將持續投入社會公益，發揮企業正向影響力，打造更有愛的社會。			
2.社區關懷 暉盛長期關注在地關懷，盼透過實際行動，營造溫馨、互助的社區氛圍，定期於重要節慶前夕致贈禮品予社區長者，傳遞溫暖與關懷，由同仁親自前往發放，並與長輩們互動交流，展現企業善盡社會責任的精神。			
3.「用愛扶持」喜憨兒 暉盛響應公益，以實際行動支持喜憨兒基金會，採購其產品作為企業贈禮，傳遞愛與關懷，盼為憨兒們創造穩定工作機會，落實企業社會責任。未來將持續關注弱勢族群，攜手共築友善、包容的社會。 請參考本公司網站企業社會責任相關資訊，網址： https://www.nemstek.com.tw 。 本公司位於台南市安南區，114年度於在地推動社區回饋與關懷，共支出於仁愛之家50,624元，鹽田里123,770元，喜憨兒46,883元，安南區低收入戶補助106,160元。另有支持文化表演包含贊助鹽田里布袋戲70,000元。			

(六) 公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>暉盛科技的董事會在永續發展委員會中，扮演的是最終的監督與決策角色，負責設定方向並將永續發展策略整合到公司營運。</p> <p>高階管理階層則組成委員會的核心，負責審議、擬定策略並推動執行，確保永續目標與公司業務緊密結合。</p> <p>2025年(亦為永續報告書基準年)，本公司成立永續發展的兼職單位，掌握全球永續發展脈動，分析治理、環境及社會等永續議題，結合營運核心、產品創新與服務，訂立策略性永續方向與專案推動。並設有永續長作為單位管理代表，負責掌握解析全球永續脈動、管理永續政策目標和具體行動，並按季報告審計會與董事會關於ESG目標達成情形。</p> <p>另外，永續長亦定期向董事會報告永續推動計畫進度，並由董事會監督各項計畫；每季至少開會一次及不定期召開重大性議題討論。且永續報告書將呈報董事會審核後發行。</p>
<p>二、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>風險：本公司之產業特性並無環境汙染問題，故僅就一般環境風險進行評估</p> <p>1.物理風險：可能導致資產損壞、營運中斷、供應鏈受阻。</p> <p>(1)極端氣候——暴雨、淹水、颱風、熱浪、供電不穩定</p> <p>供應鏈中斷——關鍵零件斷料、運輸延遲</p> <p>製造基地遭受災害的營運中斷</p> <p>(2)長期氣候變遷：平均溫度上升、海平面上升、會影響產業的生產活動、基礎設施和生態系統。</p> <p>2.轉型風險：</p> <p>(1)政策與法規：政府為應對氣候變遷而實施的新法規、碳稅或碳定價機制，可能增加公司的營運成本或影響其產品和服務的競爭力。</p> <p>(2)技術：轉向低碳、節能經濟的技術發展，可能導致公司現有技術被淘汰，或需要大規模投資新技術以保持競爭力。</p> <p>(3)市場：消費者偏好轉變，對低碳或永續產品的需求增加，可能導致公司現有產品或服務的市場需求下降。</p> <p>(4)聲譽：公司在氣候變遷議題上的表現不佳，可能導致品牌聲譽受損，影響客戶、投資者和公眾的信任。</p> <p>(5)供應鏈：供應商可能面臨實體或轉型風險，進而影響公司的原物料供應和生產成本。</p> <p>(6)同業競爭：競爭對手推出更低能耗的替代技術</p>

機會：因電漿為乾式製程(綠能節能相關產業)，可以取代半導體產業中的溼式製程，因此別公司的轉型風險反而是本公司的轉型機會。

1. 乾式製程可取代溼式製程，符合減碳趨勢
2. 客戶導入 ESG 評核 → 更願意採用低碳製程設備
3. 節能型電漿電源與製程腔體提升市場需求
4. 參與半導體供應鏈的減碳專案 (如 RE100、SBTi)

短中長期營運因應策略 (依 TCFD 架構)

(一) 短期策略 (1 年內)

1. 供應鏈風險控管：

建立關鍵零件 dual-source 制度，降低氣候災害造成斷料風險
評估供應商所在地的氣候風險 (淹水、缺水、停電)

建置安全庫存 (Safety Stock) 與關鍵備品

2. 工廠韌性提升：

增加緊急備援電源 (UPS、發電機)

改善廠房排水、提升防水高度

高溫期間增加空調冗餘容量以維持製程精度

3. 產品碳足跡盤查：

盤點自家電漿設備生產的碳排 (Scope 1 & 2)

建立關鍵機台 (乾式蝕刻機、改質腔體等) 之產品碳足跡模型

4. 客戶端 ESG 需求因應：

提供客戶減能耗數據、節能模式、待機低能耗功能

提供設備使用階段的節能改善報告

(二) 中期策略 (1-3 年)

1. 低碳產品與節能技術開發：

開發低功率電漿源 (RF/DC)，降低能耗 10-30%

改善真空腔體隔熱結構，使 pump load 減少

研發可降低氣體用量之高效率電漿均勻性技術

推出自動化乾式清洗取代溼式清洗

2. 建置環境管理系統與碳管理制度：

導入碳排監控系統 (能源用量即時監控)

	<p>與上游氣體與材料供應廠合作降低碳足跡</p> <p>3. 強化營運基地與供應鏈韌性： 在不同氣候區位發展第二供應基地 與物流夥伴建立氣候風險 SOP（颱風前後備援路線）</p> <p>4. ESG 機會導向拓展： 搶占客戶溼式製程轉乾式製程的替代市場 成為晶圓廠節能專案之設備合作夥伴 參與半導體大廠的淨零供應鏈計畫（如 TSMC / Samsung / Intel）</p> <p>（三）長期策略（3-10 年）</p> <p>1. 產品線全面低碳化： 推出「Zero-Chemical Plasma Line」，以乾式製程全面替代部分溼式蝕刻 透過材料回收、熱回收、氣體回收等系統，降低整體製程碳排</p> <p>2. 氣候相關研發與前瞻投資： 新一代高密度等離子體技術（HDP、ICP） 低溫電漿應用於 3D 結構蝕刻、先進封裝 與客戶共同開發 ESG-Ready 製程腔體</p> <p>3. 全廠淨零排放（2035-2050）： 光電設備全面更換為高效率設備 部署屋頂光電 / 綠電購買 (PPA) 長期參與碳權市場以抵銷不可避免排放</p> <p>4. 國際市場拓展： 進入歐美日等高 ESG 法規地區 符合 CBAM / 碳邊境調整機制的設備產品線 電漿設備（可取代溼式蝕刻 / 研磨 / 改質）面對氣候變遷之短中長期營運因應策略與財務影響</p>
<p>三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>（一）物理風險造成的財務影響</p> <p>1. 成本增加：工廠停電或淹水 → 生產中斷造成產能折損；關鍵零件交期延遲 → 增加緊急採購成本 5-15%；保險費率上升（尤其是淹水與颱風）</p> <p>2. 資本支出（CapEx）增加：增設排水、防洪、UPS、冷卻設備提高資本支出；供應鏈風險分散（第二供應基地）需額外投資 3. 收入衝擊：若停工 1-2 週，對年度出貨造成 5-10% 延遲；客戶先進製程線停擺導致設備驗收時程遞延</p>

	<p>(二) 轉型風險造成的財務影響</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法規成本上升：本地碳費（如台灣碳費 300–600 元／噸）；使用耗能較高設備的客戶會要求更低碳替代方案，若未改善恐造成訂單價格壓力 2. 研發及設備投入：節能型腔體、電源與氣體效率改善需提高研發費用（R&D +5–15%） 3. 若未符合 ESG 要求之營收風險：國際半導體大廠逐年提高供應商減碳標準，若未通過 ESG 評估，可能限制參與先進製程的新專案 <p>(三) 氣候機會帶來的財務正面影響</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 市場成長：乾式製程取代溼蝕刻，可增加潛在 TAM（Total Addressable Market）；預估長期每年新增 5–10% 的乾式替代需求 2. 客戶需求提升：減少化學品用量 → 客戶降低環保費用；節能型設備可在投標中取得 ESG 加分 → 提高得標率 3. 收益增加：推出低碳設備後可提升單機售價 10–20%；維護服務（節能調校、耗材減量）帶來 recurring income
<p>四、敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>一、氣候風險之辨識及評估</p> <p>面對日益惡化的極端氣候，具備因應氣候災害的韌性是企業營運的重要一環。暉盛科技預計將建置企業風險管理 (ERM) 系統，以風險矩陣 (Risk Map) 評估風險事件發生的頻率及對本公司營運衝擊的嚴重度，定義風險控管的優先順序與風險等級，並依風險等級採取對應的風險管理策略。評估結果顯示，氣候變遷相關風險包含旱災、強颱、強降雨、地震、電力及水資源短缺，以及日趨嚴格的法規要求。</p> <p>暉盛科技以情境模擬進行對應緩解措施之訓練及演練，並預計每季定期審視風險變化與因應對策。</p> <p>自 2025 年起，暉盛科技每 2 年根據氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 架構鑑別氣候風險與機會，參酌國際機構的研究報告，評估氣候變遷風險與因應措施，找出潛在風險與機會。同時，預計建立跨部門單位於「氣候變遷風險與機會工作坊」中針對政策、法規、市場、技術、聲譽、實體風險等議題鑑別出的風險與機會進行排序，依鑑別結果建立衡量指標進行目標管理，有效掌握因應作為的進度與成果，進而降低氣候風險對營運所造成的財務影響。</p> <p>經評估後，判定「淨零碳排、法規-碳費、急性氣候變化-洪災」為前三大風險。針對此三大風險，考量內部與外在環境變化及參考國內外各企業揭露的方法學，進行衝擊財務量化評估，以「治理」、「策略」、「風險管理」和「指標和目標」四個面向，擬定因應氣候變遷之策略與行動，以期降低氣候風險的衝擊，提升組織氣候韌性。</p>

	<p>二、面對氣候變遷風險發生時之管理作為</p> <p>氣候變遷風險包含「物理風險」與「轉型風險」。公司已建置標準化應變措施，以確保在極端氣候事件或政策變動時之營運韌性：</p> <p>(一) 實體風險發生時的管理作為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 緊急應變與營運持續 (BCP) 啟動：啟動營運持續計畫 (BCP) 與緊急應變中心 (EOC)；依事件類型 (淹水、停電、颱風、熱浪) 啟動對應 SOP；優先確保人員安全、設備安全、資料中心與關鍵生產設備的正常運作。 2. 工廠與設備防護：啟動備援電源 (UPS/發電機)；關閉可能受損之精密製造設備、真空腔體或高壓電漿電源，防止損害擴大；對倉庫及關鍵零組件進行加固與移置。 3. 供應鏈備援與交期管理：對關鍵零件啟動多來源 (dual-source) 備援機制；緊急調整生產排程，並與客戶溝通交期；視風險級別啟動安全庫存釋放機制。 4. 訊息透明與客戶溝通：於事件發生後 24 小時內向客戶與供應鏈夥伴通報影響程度；更新預估復工時程與交期調整計畫，讓客戶提前因應。 <p>(二) 轉型風險發生時的管理作為</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法規與碳成本因應：由永續委員會與財務部門共同評估碳費、碳稅、能源法規之影響。若成本上升則啟動：設備節能研發的加速投資；與供應商合作 降低材料碳足跡；與客戶協商新設備之碳效率指標。 2. 市場與技術替代風險應對：當客戶加速淘汰高化學耗用之溼式製程時，立即：擴大乾式製程 (蝕刻、改質、清洗) 技術迭代；推出節能模式、低能耗電漿源；調整產品 roadmap 支應 ESG 需求。 3. ESG 評核與供應商管理：若供應商因 ESG 評比不佳而受限制，立即啟動替代供應商開發流程；針對高風險供應商要求提供減碳計畫與改善期限。
<p>五、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>一、治理</p> <p>董事會定期審視氣候變遷相關的風險與機會，以及管理階層在評估和管理氣候相關風險與機會的角色。</p> <p>每季至少召開 ESG 永續發展推行狀況與相關風險與機會之評估相關會議，討論公司治理、社會及環保節能等企業永續議題，氣候變遷之因應亦為討論議題之一，討論事項並列入決議或需執行事項，需進行後續追蹤改善。</p> <p>二、策略</p> <p>利用 TCFD 架構，定期鑑別短、中、長期氣候相關的風險與機會。</p> <p>氣候相關風險與機會對組織的營運、策略和財務規劃之衝擊。</p>

	<p>考量不同氣候情境下（包括 2°C 或更嚴苛的情境），組織策略的韌性。</p> <p>運用 TCFD 手法，跨部門討論鑑別短、中、長期氣候相關的風險與機會。</p> <p>以三種不同情境估算（政府淨零路徑、科學基礎減碳目標（SBT）中要求的 2050 年以前達成淨零的減碳路徑）在未來實施減碳策略所需投入的轉型成本，以了解不同策略下在不同情境可能的財務衝擊。</p> <p>暉盛科技之電漿低碳產品將進一步提升技術水準來滿足客戶更多 ESG 需求，並回覆產品碳足跡的資訊。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 要求使用低碳產品或設備的供應商，並與這些供應商建立合作關係，開發綠色低碳材料和生產設備。 2. 使用低碳運輸工具運輸產品和材料。 3. 目前與環境保護可持續發展相關的產品為使用於環保型半導體晶片研磨與蝕刻電子設備，今後將繼續加強創新管理，逐步將市場經濟的發展與環境保護相結合。 <p>三、風險管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以衝擊程度與發生率評估氣候變遷帶來之相關風險與機會的顯著性，並設定相關因應方案。 2. 將氣候風險鑑別與評估結果，納入企業風險管理（ERM）項目中，定期由高階管理階層確認。 3. 評估相關單位於氣候變遷風險與機會工作坊中討論的重大氣候相關風險／機會的財務定性化與定量化衝擊。 4. 鑑別出之重大風險，包含碳費（稅）開徵、法規與客戶對再生能源需求、國家能源政策改變等、估算其財務衝擊，並於年度風險管理委員會議向高階管理階層報告及審視。 <p>四、指標與目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設定衡量氣候風險與機會之管理指標與目標。 2. 制訂溫室氣體管理與能資源循環再利用目標。 3. 進行 100% 產品環境足跡之盤查，並推動碳足跡熱點分析改善。 4. 完成符合能源大戶再生能源法規要求，設定再生能源中長期目標。 5. 每年進行溫室氣體範疇一/二/三之盤查及查證，確認溫室氣體產生源並進行重點管理。 6. 完成 2025 年碳足跡之盤查，並將 2025 年盤查結果之碳足跡熱點，進行管理方案改善。 7. 依再生能源購買規劃時程，2026 年將再設置屋頂太陽能電廠一座，以達成 2026 年淨零排放之目標。
<p>六、若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，</p>	<p>（一）氣候風險辨識流程（Identify） 每年由永續委員會與各部門依流程進行：</p>

說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。

1.外部環境分析

蒐集國內外氣候政策（碳費／碳稅／CBAM）

檢視客戶 ESG 要求（SBTi、RE100、供應商信任度評量）

分析極端氣候趨勢（高溫、淹水、颱風、供電風險）

2.內部營運風險辨識

工廠位置（淹水/土石流/停電易發區）

供應鏈關鍵零件所在地之氣候暴露度

用電強度高的製程設備

客戶導入低碳製程後產品替代性提升的影響

3. 依 TCFD 分類風險

物理風險：急性（颱風、暴雨）、慢性（高溫、缺水）

轉型風險：政策、技術、市場、聲譽

（二）氣候風險評估流程（Assess）

採用 兩階段評分法：

1. 量化評估（財務影響） 評估不同事件發生時的：

產能損失（如 1-2 週停工）

成本增加（急單採購、保險費調整）

潛在減產對年度營收的影響

預估氣候法規造成的碳成本（碳費／碳稅）

2. 風險矩陣評估（影響 × 發生可能性）

分為四級：低、中、中高、高

納入 ERM 的風險熱圖（Risk Heat Map）

3. 情境分析（Scenario Analysis）

依 TCFD 指引評估兩種情境：

1.5°C/2°C 低碳情境 → 轉型風險高

4°C 高排放情境 → 物理風險高

評估對製造、供應鏈與客戶需求的差異影響。

（三）氣候風險管理流程（Manage）

氣候風險正式納入公司的 ERM 系統，依以下方式管理：

1. 納入公司年度風險盤點機制 永續委員會向董事會提供氣候風險管理報告 與「財務風險、營運風險、供應鏈風險」一併處理 風險權責單位明確分配（研發、製造、採購、財務）

	<p>2. 訂定風險應對策略 (4 類) 避免 (Avoid) 降低 (Mitigate) 轉嫁 (Transfer, 例如保險) 接受 (Accept)</p> <p>3. 建置控制措施</p> <p>物理風險控制：防洪、備援電力、備庫管理、第二生產基地 轉型風險控制：節能技術投資、產品能耗改善、供應鏈碳管理 客戶風險控制：提供 ESG-ready 設備、碳足跡盤查、節能數據</p> <p>4. 定期監測與回饋 每季 ESG 例會更新氣候風險狀況 每年向董事會呈報氣候風險與財務影響 若市場需求快速變化，啟動 R&D roadmap 調整</p> <p>(四) 氣候資訊整合至整體風險管理制度 (ERM Integration) 氣候風險不是獨立管理，而是與 ERM 完全整合：</p> <p>1. 組織層級整合 董事會：審查氣候風險與淨零策略 永續委員會：跨部門管理氣候議題 風險管理委員會／內控部門：將氣候議題納入年度風險盤點 各部門：研發、製造、採購、財務共同執行</p> <p>2. 政策與流程整合 氣候議題納入 ERM 政策、BCP、供應商管理制度、R&D 投資決策流程 新產品開發 (NPI) 須評估能耗、碳足跡與 ESG 貢獻度</p> <p>3. 指標與目標整合 產品能耗改善 KPI 碳排減量目標 (Scope 1/2/3) ESG 對標客戶評級 (TSMC / SAMSUNG / Intel Supplier Rating)</p> <p>4. 報告與稽核整合 每年發布 TCFD 或永續報告 內外部稽核單位進行檢核 實際績效回饋至 R&D 與資本支出計畫</p>
<p>七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>公司之情境應無需要繳納碳定價之評估。</p>
<p>八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應</p>	<p>1. 2025 年進行溫室氣體盤查，依據相關資料擇定"基準年"，並預計兩年內設置太陽能發電與儲電等相關綠電設備，預計可取得再生能源憑證約 10 張。</p> <p>2. 規劃期程及達成進度等資訊以於本表第二項之「短中長期目標」及本表第五項之「指標與目標」欄位詳述，請參照相關內容。</p>

<p>說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	
<p>九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。</p>	<p>2025 年後會擇定一年進行外部保證，可能會與會計師事務所配合進行外部確信。</p>

2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1)溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

直接排放量：640.5457 公噸 CO₂e；間接排放量：1,598.6689 公噸 CO₂e，因 2025 年為基準年，尚無兩年度資料。

密集度：4.239 CO₂e/百萬元

資料涵蓋範圍：台南市安南區科技五路 100 號

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入 電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能 源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接 排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書(Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol)或國際標準組織(International Organization for Standard-ization, ISO)發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額(新臺幣百萬元)計算之數據。

(2)溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

2025 年後會擇定一年進行外部保證，可能會與會計師事務所配合進行外部確信。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

3.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

(一) 短期策略 (1 年內)

1. 供應鏈風險控管：

建立關鍵零件 dual-source 制度，降低氣候災害造成斷料風險

評估供應商所在地的氣候風險 (淹水、缺水、停電)

建置安全庫存 (Safety Stock) 與關鍵備品

2. 工廠韌性提升：

增加緊急備援電源 (UPS、發電機)

改善廠房排水、提升防水高度

高溫期間增加空調冗餘容量以維持製程精度

3. 產品碳足跡盤查：

盤點自家電漿設備生產的碳排 (Scope 1 & 2)

建立關鍵機台 (乾式蝕刻機、改質腔體等) 之產品碳足跡模型

4. 客戶端 ESG 需求因應：

提供客戶減能耗數據、節能模式、待機低能耗功能

提供設備使用階段的節能改善報告

(二) 中期策略 (1-3 年)

1. 低碳產品與節能技術開發：

開發低功率電漿源 (RF/DC)，降低能耗 10-30%

改善真空腔體隔熱結構，使 pump load 減少

研發可降低氣體用量之高效率電漿均勻性技術

推出自動化乾式清洗取代溼式清洗

2. 建置環境管理系統與碳管理制度：

導入碳排監控系統 (能源用量即時監控) 與上游氣體與材料供應廠合作降低碳足跡

3. 強化營運基地與供應鏈韌性：

在不同氣候區位發展第二供應基地

與物流夥伴建立氣候風險 SOP (颱風前後備援路線)

4. ESG 機會導向拓展：

搶占客戶溼式製程轉乾式製程的替代市場

成為晶圓廠節能專案之設備合作夥伴 參與半導體大廠的淨零供應鏈計畫 (如 TSMC / Samsung / Intel)

(三) 長期策略 (3-10 年)

1. 產品線全面低碳化：

推出「Zero-Chemical Plasma Line」，以乾式製程全面替代部分溼式蝕刻
透過材料回收、熱回收、氣體回收等系統，降低整體製程碳排

2. 氣候相關研發與前瞻投資：

新一代高密度等離子體技術 (HDP、ICP)

低溫電漿應用於 3D 結構蝕刻、先進封裝

與客戶共同開發 ESG-Ready 製程腔體

3. 全廠淨零排放 (2035-2050)：

光電設備全面更換為高效率設備

部署屋頂光電 / 綠電購買 (PPA)

長期參與碳權市場以抵銷不可避免排放

4. 國際市場拓展：

進入歐美日等高 ESG 法規地區

符合 CBAM / 碳邊境調整機制的設備產品線

電漿設備 (可取代溼式蝕刻 / 研磨 / 改質) 面對氣候變遷之短中長期營運因應策略與財務影響

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(七) 履行誠信經營情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		<p>(一)本公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「董事及經理人道德行為準則」並揭露於公司網站，除作為落實誠信經營之依據，並藉以明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾。</p> <p>(二)本公司為防範不誠信行為，已針對具較高不誠信行為風險之營業活動，於規章及對外文件中加強相關防範措施。此外，本公司會對員工進行教育與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、理念及違反誠信行為之後果，其內容符合至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施，使員工明確知悉其應遵守之規範，藉此降低不誠信行為之發生。</p> <p>(三)本公司已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」及「員工行為準則」，作為落實誠信經營之依歸，具體規範相關同仁執行業務時應注意之相關事項。若發現有任何違反法令或章程規範嫌疑之情事，亦訂有舉報機制及違規懲戒之相關規定，並落實執行與檢討。</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V		<p>(一)本公司與他人簽訂契約時，內容應包含遵守誠信經營政策，任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。</p> <p>(二)本公司由總經理室負責誠信經營政策之制定，若發現不誠信行為時，應將處理方式及後續檢討改善措施向董事會報告。</p> <p>(三)訂定於「董事及經理人道德行為準則」，提供適當管道供董事及經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(四)本公司已訂定「會計制度」及「內部控制制度」供管理階層及員工遵守，另針對防止內線交易制定作業程序，以確保落實誠信經營政策。由內部稽核人員不定期查核法令遵循之情形，若接獲檢舉，經查證屬實時應採取適當的處置或法律程序，以檢討並確保制度之設計及執行持續有效。</p> <p>(五)本公司主管對員工進行教育與宣導，另針對新進員工予以宣導內部規定和法令。已執行之課程說明包含 114.09.09 反貪腐教育訓練共計 72 人次，114.01.05 個人資料保護教育訓練共計 75 人次，各為 3 小時。</p>	無重大差異。
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p>	V		<p>(一)本公司已訂定「檢舉辦法」，建立明確並便利之檢舉管道，針對被檢舉對象指派適當之受理單位。</p> <p>(二)本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」訂有受理檢舉事項之相關保密機制及調查標準作業程序，同仁懷疑或發現有違反法令規章或誠信經營、道德行為準則之行為時，得向適當人員，如：獨立董事、經理人、內部稽核主管呈報、舉發。</p> <p>(三)本公司將以保密方式處理呈報、舉發案件，且竭盡全力保護檢舉人的安全，使其免於遭受報復或不當處置。</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？				
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已於公開資訊觀測站及公司官網揭露 (https://www.nemstek.com.tw)。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

智慧財產管理計畫及當年度執行情形報告：

1. 智慧財產管理計畫

本公司以研發為核心，自創立以來即高度重視技術創新與發展，並致力於研發成果及智慧財產的保護，深信唯有落實智慧財產相關制度，方能確保技術領先地位與核心競爭力，因此，為配合營運策略與產業趨勢，公司持續精進智慧財產管理機制，訂定完善的管理作業流程，以提升智慧財產管理的整體品質與效益。

2. 智慧財產之取得、保護、維護和運用作業

為落實智慧財產政策與達成相關目標，本公司依據營運藍圖及最新法規，規劃各項創新研發活動，建立並持續強化智慧財產管理制度。透過完善的管理機制，確保研發成果能順利轉化為智慧財產權，並獲得周延且有效的保護。同時，整合與運用高價值的智慧財產資產，以創造多元商業利益，進而強化本公司之競爭優勢與防禦能力。

3. 執行情形/成果

專利	已領證件數共 10 件：「發明」專利計 8 件，「新型」專利計 2 件
	申請中共 3 件：「發明」專利計 3 件
商標	已獲准之商標權共 10 件

(九) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

請參閱公開資訊觀測站，相關路徑如下

1. 內部控制聲明書：公開資訊觀測站→單一公司→公司治理→公司規章/內部控制→內控聲明書公告，輸入年度及公司代號。

網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：公開資訊觀測站→單一公司→公司治理→公司規章/內部控制→內部控制專案審查報告，輸入年度及公司代號。

網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06hsg20>

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 114 年度股東會之重要決議

日期	重要決議
114 年 6 月 18 日	1. 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 112 年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 本公司盈餘轉增資發行新股案。

2. 董事會之重要決議：請參閱 114 年度年報董事會運作情形

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、會計師公費資訊

附表二之四

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費					備註
				制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計	
國富浩華聯合會計師事務所	李國銘	114 年度	1,560	無	118	無	600	718	2,278
	郭怡伶								

註：非審計公費包含稅簽服務、盈餘轉增資文件覆核及公開發行內部控制專案審查。。

(一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師

更換日期	民國 114 年 12 月 17 日經董事會通過自 114 年第四季起更換		
更換原因及說明	配合國富浩華聯合會計師事務所內部輪調		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情況	當事人	會計師
		委任人	
	主動終止委任 不再接受(繼續)委任	不適用	
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	V	
說明			
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	國富浩華聯合會計師事務所
會計師姓名	郭怡伶
委任之日期	民國 114 年 12 月 17 日經董事會通過自 114 年第四季起更換
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東，股權移轉及股權質押變動情形

附表三 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形 單位：股

職 稱	姓 名	114 年度		115 年截至 年報刊印日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長暨 大股東	宋俊毅(註 1)	553,224	—	—	—
董事暨 大股東	基丞科技(股)公司	872,551	—	—	—
	代表人:江少杰	—	—	—	—
董事	曾坤燦	419,847	—	—	—
董事暨總經理	許嘉元	271,331	—	—	—
獨立董事	顏盟峯	—	—	—	—
獨立董事	黃蕙玲	—	—	—	—
獨立董事	何志文	—	—	—	—
生產部 部經理	符永豪	70,000	—	—	—
行銷部 部經理	邱冠陸	194,512	—	(8,000)	—
財會部 經理	蔡郁仁	35,020	—	600	—

註 1：112.09.22 起為本公司大股東。

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人資訊：無

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

附表三之一

115年3月31日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
基丞科技(股)公司	5,235,307	14.23	-	-	-	-	-	-	-
代表人：江少杰			-	-	-	-	-	-	-
宋俊毅	3,769,197	10.24	368,769	1.00	-	-	宋晟豪	一親等	-
							宋竑億	一親等	-
矽格聯測(股)公司	3,021,708	8.21	-	-	-	-	-	-	-
代表人：黃興陽			-	-	-	-	-	-	-
曾坤燦	2,519,082	6.85	-	-	-	-	-	-	-
蔡秉儒	1,737,508	4.72	-	-	-	-	-	-	-
許嘉元	1,517,981	4.13	27,600	0.08	-	-	-	-	-
邱冠陸	1,295,000	3.52	-	-	-	-	-	-	-
宋晟豪	1,247,908	3.39	-	-	-	-	宋俊毅	一親等	-
							宋竑億	二親等	
宋竑億	1,222,136	3.32	-	-	-	-	宋俊毅	一親等	-
							宋晟豪	二親等	
方淑卿	1,185,697	3.22	320,000	0.87	-	-	-	-	-

註：股東會之停止過戶期間為 115/3/23~115/5/21，115/3/18 為市場最後買進日。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：不適用。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

附表五

115年3月31日單位：新台幣仟元；仟股

年/月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
108.5	10	28,000	280,000	19,204	192,048	盈餘轉增資64,016仟元	無	註1
108.8	14	28,000	280,000	22,831	228,311	現金增資36,263仟元	無	註2
111.10	10	28,000	280,000	26,256	262,558	盈餘轉增資34,247仟元	無	註3
112.11	19	60,000	600,000	28,860	288,598	員工認股權轉換26,040仟元	無	註4
114.08	10	60,000	600,000	34,632	346,317	盈餘轉增資57,719仟元	無	註5
114.11	72	60,000	600,000	36,797	367,967	現金增資21,650仟元	無	註6

- 註1：108.05.21 府經工商字第 10800342820 號核准。
 註2：108.08.28 府經工商字第 10800421770 號核准。
 註3：111.10.05 府經工商字第 11100203850 號核准。
 註4：112.11.08 府經商字第 11200316000 號核准。
 註5：114.08.14 府經商字第 11400454350 號核准。
 註6：114.11.20 府經商字第 11400545880 號核准。

2. 股份種類

115年3月31日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名普通股	36,796,731	23,203,269	60,000,000	上市(創新板)股票

3. 若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單

附表八

115年3月31日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
基丞科技(股)公司		5,235,307	14.23%
宋俊毅		3,769,197	10.24%
矽格聯測(股)公司		3,021,708	8.21%
曾坤燦		2,519,082	6.85%
蔡秉儒		1,737,508	4.72%
許嘉元		1,517,981	4.13%
邱冠陸		1,295,000	3.52%
宋晟豪		1,247,908	3.39%
宋竑億		1,222,136	3.32%
方淑卿		1,185,697	3.22%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司每屆決算所得盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，得併同累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案。本項盈餘分派以發行新股方式為之，應提請股東會決議分派之。

分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或部份，如以發放現金方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，就當年度可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之五時，得不予分配；分配股東股利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之分派比例不低於分派股利總額之百分之十。若公司有重大投資或發展政策時，得全數以股票股利發放之。

2. 執行狀況

本公司 114 年度盈餘分配案業經 115 年 3 月 4 日董事會決議通過，擬發放股票股利 18,398,370 元轉增資發行新普通股計 1,839,837 股及現金股利 36,796,731 元，分配案將提 115 年 5 月 21 日股東常會決議。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司因未公開 114 年完整式財務預測，故不適用揭露預測性財務資訊之影響。

(五) 員工、董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應依下列比率提撥董事酬勞與員工酬勞：(一)董事酬勞：不高於百分之六；惟獨立董事不參與董事酬勞之分配。(二)員工酬勞(含基層員工酬勞不低於員工酬勞之 45%)：百分之二~十。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。董事酬勞及員工酬勞分派案應由董事會決議，並提股東會報告。

第一項員工酬勞之發放得由董事會決議得以現金或股票為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

2. 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

本公司估列員工、董事酬勞係依公司章程所定之提撥成數計算，認列為薪資費用。如實際配發金額與估列金額有差異時，則依會計估計變動處理，調整分配年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形

本公司業於 115 年 3 月 4 日董事會決議通過分派 114 年度員工酬勞新台幣 8,032 仟元(本項目員工酬勞數額提撥計新台幣 3,614 仟元為基層員工酬勞)及董事酬勞新台幣 1,806 仟元，全數採現金發放，與原估列數並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

(3)前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

本公司 113 年度員工酬勞及董監酬勞業經 114 年 3 月 19 日董事會通過及 114 年 6 月 18 日股東常會報告，已於 114 年 12 月 31 日前發放 113 年度員工酬勞新台幣 9,781 仟元及董監酬勞新台幣 1,772 仟元完畢，與估列數並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

(三)最近三年度及截至年報刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

(一)計畫內容：

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容：

1.計畫內容：

(1)主管機關核准日期及文號：民國 114 年 9 月 22 日臺證上二字第 1141703828 號。

(2)計畫所需資金總額：新台幣 155,880 仟元。

(3)資金來源：現金增資發行普通股 2,165 仟股，每股面額新台幣 10 元，每股發行價格新台幣 72 元，募集總金額為新台幣 155,880 仟元。

(4)計畫項目及預計資金運用進度：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預定資金運用情形	
			115 年度	
			第 1 季	
充實營運資金	115 年第 1 季	155,880	155,880	
合計		155,880	155,880	

(5) 資金運用情形

單位：新台幣仟元

計畫項目	執行狀況	114 年第 4 季		截至 114 年第 4 季 累計		進度超前或落後之原因 及改進計畫
		預定		預定		
充實營運資金	支用金額	預定	100,000	預定	100,000	自有資金尚高於平均水位，配合營運資金需求，部分資金延至 115 年第一季使用。
		實際	6,688	實際	6,688	
	執行進度	預定	64.15%	預定	64.15%	
		實際	4.29%	實際	4.29%	
合計	支用金額	預定	100,000	預定	100,000	
		實際	6,688	實際	6,688	
	執行進度	預定	64.15%	預定	64.15%	
		實際	4.29%	實際	4.29%	

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

本公司致力於提供半導體產業、IC 載板與印刷電路板(以下簡稱 PCB)產業、平面顯示器與 LED 等光電產業、太陽能產業、非電子業及民生工業等各式製程間，所需的電漿清潔、電漿蝕刻以及電漿表面改質之解決方案與電漿設備等研發、生產及銷售。

2. 主要業務之營業比重

單位：新台幣仟元；%

產品別	年度	113 年度		114 年	
		金額	%	金額	%
機 台 銷 售		493,569	90.13	439,828	84.84
維 修 收 入		54,061	9.87	78,609	15.16
合 計		547,630	100.00	518,437	100.00

3. 公司目前之商品(服務)項目

產業	產品項目
PCB	電漿清洗機、電漿蝕刻機、電漿去膠渣機、電漿鑽孔機
半導體	電漿清洗機、電漿蝕刻機、電漿極化機、電漿去光阻機
光電	電漿清洗機、電漿蝕刻機、電漿極化機、電漿表面改質機
其他	電漿清洗機、電漿生化處理機、電漿廢氣處理設備、全氟化物電漿分解處理機、電漿廢水處理設備、電漿高溫減廢設備

4. 計畫開發之新商品(服務)

產業	產品項目
PCB	微細線路用非等向性蝕刻電漿方案、全乾法電漿去膠渣與蝕刻
半導體	晶圓再生電漿處理機、電漿晶圓薄化機、電漿晶圓切割機、混合鍵合及 3D 立體封裝電漿解決方案
光電	PLP 製程所需電漿清潔與蝕刻機(玻璃基板與有機基板)
其他	各式節能減碳及創造新能源電漿處理方案

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

電漿技術一直是微電子器件(microelectronic devices)製造中重要的一環。至今，電漿技術的觸角已延伸到各行各業，在廣泛的應用領域中發揮著重要作用。本公司應用電漿技術，研發生產一系列乾式電漿清洗、電漿蝕刻、電漿表面改質、電漿分子裂解等相關設備。

電漿清洗/蝕刻/改質是一種經過驗證、有效、經濟且環保的關鍵表面處理方法，與傳統的濕式清潔方法相比，使用電漿進行離子清洗可藉由高溫或強電磁場使物質解離，釋放出離子和自由基，破壞樣品表面上有機污染物或無機物之鍵結，此時腔體中所通入的反應氣體離化產生正負離子、自由基等粒子，這些粒子會與有機污染物或無機物的鍵結結合，形成氣態之化合物如 CO₂ 和 H₂O，再藉由幫浦抽離腔體。電漿清洗優點在於不會造成環境污染，經電漿清洗，表面回歸未受污染狀態，可在無有害廢料情況下進行黏合或進一步製程。電漿蝕刻是製作半導體元件經常需要用到的技術，讓物件的表面用反應氣體來進行蝕刻，清除表面污染。表面的材料被蝕刻後，轉化為氣體並由真空系統去除，表面積增加可提高表面性能。乾式電漿蝕刻技術於光電及半導體相關產業之應用已經相當成熟與廣泛，但隨著科技發展不斷地進步，相關製程技術之規格亦愈來愈高，例如在半導體晶圓加工製程已由微米尺度微縮為奈米尺度之精準度。在不斷追求高精度與高效能的市場趨勢下，蝕刻製程除了在矽晶圓加工技術仍需要精進與突破之外，找到蝕刻製程更多其他的應用亦是未來新興產業萌芽之機會。而電漿表面改質技術，則能於材料表面形成特定官能基，來達到黏合或接著度的需求。材料經電漿處理後，能於分子結構中，產生自由基，有助於改善材料表面之其他材料相容性。

本公司主要產品應用領域為半導體先進封裝、ABF 載板、PCB 及新能源與環保應用產業等，其產品應用相關行業之現況與發展分析如下：

(1) 半導體先進封裝產業

隨著人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC) 與資料中心需求快速成長，半導體先進封裝市場持續擴大。先進製程微縮逐漸接近物理極限，使晶片效能提升逐漸轉向透過封裝技術實現系統級整合，帶動先進封裝需求增加。根據市場研究機構 Grand View Research 的資料，全球先進封裝市場於 2024 年規模約為 396 億美元，並呈現穩定成長趨勢，預估 2025 年至 2030 年年複合成長率 (CAGR) 約為 5.7%。從技術結構觀察，覆晶封裝 (Flip-Chip)、扇外型晶圓級封裝 (Fan-Out WLP)、嵌入式晶片封裝 (Embedded-Die) 及 2.5D/3D 異質整合封裝均為主要技術，其中 2.5D/3D 封裝因可支援高頻寬記憶體 (HBM) 與 Chiplet 架構，已成為高階運算晶片的重要解決方案，帶動先進封裝市場持續成長 (詳圖 1)。

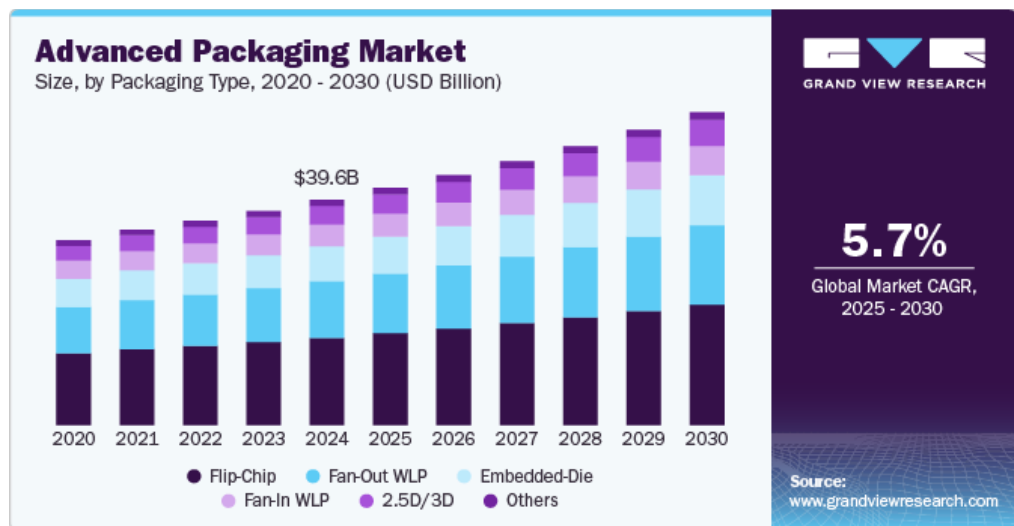
先進封裝製程涉及多層材料結構與高密度互連技術，對於表面潔淨度與材料界面處理要求極高，因此電漿製程已成為封裝製程中的重要關鍵技術之一，在晶圓級封裝、再配線層 (RDL) 製程、扇外型封裝及晶片堆疊接合等製程中廣泛應

用。特別是在 2.5D/3D 異質整合與 Hybrid Bonding 製程中，電漿表面處理可提升接合界面的潔淨度與反應活性，進而提高接合良率與製程可靠度。

先進封裝產業鏈的主要參與者包含晶圓代工暨 IDM 廠與專業封裝測試 (OSAT) 廠商。近年來，台積電、英特爾與三星等晶圓廠積極投入先進封裝技術研發並持續擴充產能，以支援 AI 與 HPC 應用對高密度互連與高頻寬傳輸的需求。例如台積電的 CoWoS 與 SoIC、英特爾的 Foveros 等技術均屬於先進封裝整合方案，可透過 2.5D/3D 封裝技術實現晶片堆疊與異質整合。同時，全球封裝產業仍以專業封測廠為重要支柱，包括日月光投控 (ASE)、艾克爾 (Amkor) 及矽品 (SPIL) 等龍頭廠商，透過晶圓級封裝 (WLP) 與覆晶封裝 (Flip-Chip) 等製程技術持續提升產能與技術能力。隨著 AI 加速器、高效能運算與資料中心需求持續成長，先進封裝已逐漸成為半導體產業的重要成長動能，各大廠亦持續加大資本支出以擴充先進封裝產線並強化技術競爭力。

在 Hybrid Bonding 與晶片接合製程中，本公司電漿設備可有效去除金屬與介電材料表面氧化層與污染物，提升接合界面的潔淨度與附著力，進而提高接合良率。此外，在扇外型封裝 (Fan-Out) 與再配線層 (RDL) 製程中，本公司真空電漿技術亦可用於殘膠去除與表面改質等關鍵製程。本公司憑藉電漿源設計與製程整合能力，可因應先進封裝技術持續演進的需求，成為晶圓廠與封測廠於先進封裝製程中的重要設備合作夥伴，並可望隨著先進封裝市場成長而同步受惠。

(圖 1)【全球先進封裝市場發展預測】



資料來源：Grand View Research

(2) ABF 載板產業

ABF 載板 (Ajinomoto 積層薄膜載板) 是高階 IC 封裝用的關鍵基板，近年來，隨著 AI 運算與資料中心需求快速成長，高階 GPU 與 AI 加速器晶片對高密度互連與高速訊號傳輸的需求持續提高，使 ABF 載板在高效能運算晶片封裝中的重要性日益提升。此外，5G 通訊基礎建設與 AI 資料中心的快速部署亦帶動 ABF 載板需求增加，使其成為支撐高速運算與高頻應用的重要關鍵材料。根據產業研究資

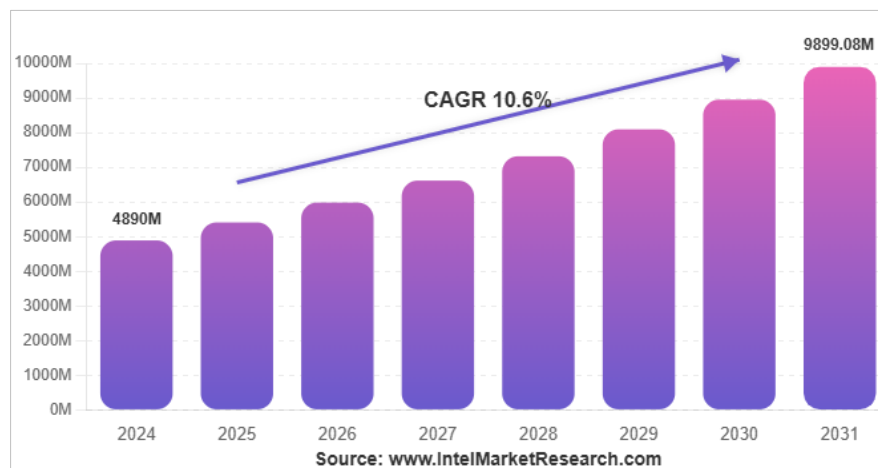
料顯示，全球 ABF 載板市場於 2024 年市場規模約為 48.9 億美元，並預估將由 2025 年的 54.2 億美元成長至 2032 年的 95.5 億美元，年複合成長率（CAGR）約為 10.6%，顯示 ABF 載板市場隨高階半導體應用需求增加而持續擴張（詳圖 2）。

在產業供應鏈方面，IC 載板產業主要集中於少數具備高階製程能力的載板廠商，包括日本、台灣與韓國等地的主要製造商。目前全球前五大 IC 載板廠商合計已攬超過一半市佔率，其中包括：臺灣欣興電子（Unimicron，市佔約 16.0%）、南韓三星電機（SEMCO，9.9%）、日本 IBIDEN（9.3%）、奧地利 AT&S（9.1%）以及臺灣南亞電路板（8.7%）（source: digitimes.com）。上述龍頭廠商積極擴充產能以滿足急速成長的 FC-BGA 基板需求。例如，日本 IBIDEN 近期宣布五千億日圓的擴大投資，欣興電子、景碩科技、南亞電路板也預計分別投入數百億元新臺幣擴產先進載板產線，以把握 HPC 與 AI 時代的商機。其他主要業者還包括美國 TTM 科技、矽品集團（ASE）以及日本京瓷等，它們亦透過併購與策略聯盟切入載板市場，專注 5G 與高效運算等應用，以維持競爭力。總體而言，儘管中國等新進玩家試圖投入先進載板領域，但目前全球高階載板產出仍以臺、日、韓廠為主，供應版圖相對穩固。

本公司針對 ABF 載板製造開發全乾式電漿處理技術，提供傳統濕製程的重要替代方案。ABF 載板由環氧樹脂及 SiO₂ 填料構成，其材料特性使蝕刻加工難度較高。本公司電漿設備可在不使用液態藥劑的情況下直接對 ABF 介電層進行乾式蝕刻，具備高速蝕刻速率、高選擇比及可控表面粗糙度，可應用於內層電路圖案化、微孔鑽孔、基板清潔及微細線路製程前處理等關鍵步驟，提升介電材料與銅導體之間的界面黏著與後續電鍍製程可靠度。

此外，本公司亦掌握無擴孔微孔垂直蝕刻技術，可在 ABF 基板形成垂直壁型微通孔，避免孔徑擴大影響線路密度。相較傳統化學濕製程，全乾式電漿流程可減少化學藥劑使用並降低環境負荷，同時提升製程穩定性與良率。隨著 AI 與高效能運算應用帶動高階 IC 載板需求成長，本公司透過高密度電漿源與精準製程控制技術，提供穩定且高效率的乾式處理解決方案，協助載板廠提升製程品質與產能，並在高階 ABF 載板產業鏈中建立重要設備技術地位。

（圖2）【全球ABF載板市場成長趨勢】



資料來源：Intel Market Research，2026年1月

(3) PCB 產業

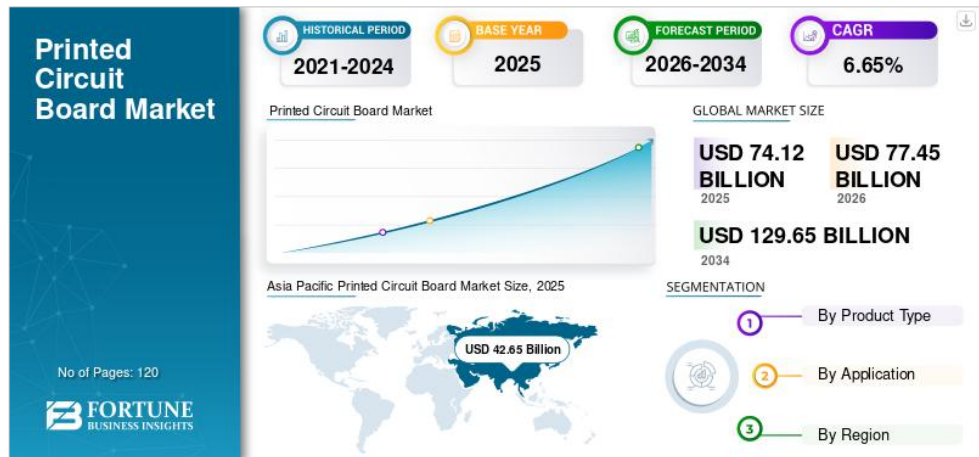
PCB 產業是電子硬體的基石，雖屬相對成熟市場但仍隨 5G 裝置、電動車與物聯網應用持續擴張。根據 Fortune Business Insights 研究，2025 年全球 PCB 市場規模約為 741.2 億美元，預計將由 2026 年的 774.5 億美元成長至 2034 年約 1,296.5 億美元，年複合成長率（CAGR）約為 6.65%（詳圖 3）。PCB 為電子產品中負責電氣連接與訊號傳輸的核心基板，廣泛應用於電腦、智慧手機、通訊設備及各類電子產品。隨著電子系統持續朝高性能、小型化與高度整合發展，高密度互連（HDI）板、多層板與可撓式 PCB 的需求亦持續提升。

由於 PCB 應用範圍橫跨消費電子、車用電子、工業控制與通訊設備等領域，全球 PCB 產業呈現高度多元且競爭激烈的格局。臺灣為全球 PCB 產業重要聚落，臻鼎科技、欣興電子、華通電腦與健鼎科技等企業在高階 HDI 板及 IC 載板領域具備領先優勢；日本廠商則長期深耕軟板與車用 PCB，例如旗勝（Nippon Mektron）在全球營收排名中長期名列前茅。中國近年亦崛起多家大型 PCB 製造商，如深南電路、景旺電子與滬電股份等，憑藉本土電子製造產業鏈快速擴張。美國與歐洲廠商則多聚焦於高可靠度市場，如美國 TTM Technologies、Jabil 及德國 Würth Elektronik 等，主要服務航太、軍工與工業電子領域。整體而言，全球 PCB 產業正持續朝高多層、高密度與柔性化方向發展。

在 PCB 製造過程中，電漿技術已成為重要的表面處理與微細加工工具。本公司電漿設備可應用於 PCB 製程中的表面清潔、去除有機污染物、表面活化及微細線路製程前處理等關鍵步驟。隨著高階 HDI 板與多層 PCB 的線路密度持續提升，傳統鑽孔與化學處理方式已難以滿足微孔與高精度線寬的製造需求。本公司真空電漿系統可執行孔壁去膠渣（Desmear）、微蝕刻及表面粗化等製程，有效提升鍍銅孔洞的可靠性與層間附著力，並可實現垂直且無擴孔的微通孔蝕刻，提高孔密度與製程精度。此外，本公司電漿設備具備良好的處理均勻性，可在大型板面上維持穩定加工效果，降低板面邊緣與中心之製程差異，對於大尺寸 PCB 與面板級封裝基板製造尤為重要。

同時，電漿乾式製程亦可降低傳統濕式化學製程所產生的污染與廢液處理負擔，符合電子製造產業朝向綠色製造與永續發展的趨勢。隨著 5G 通訊設備、AI 運算平台、車用電子與智慧裝置持續推升高密度、高可靠度 PCB 的需求，本公司電漿技術在 PCB 製程中的應用價值亦將進一步提升，為公司在全球電子製造產業鏈中建立具競爭力的利基市場。

(圖3)【全球PCB產業市場規模】



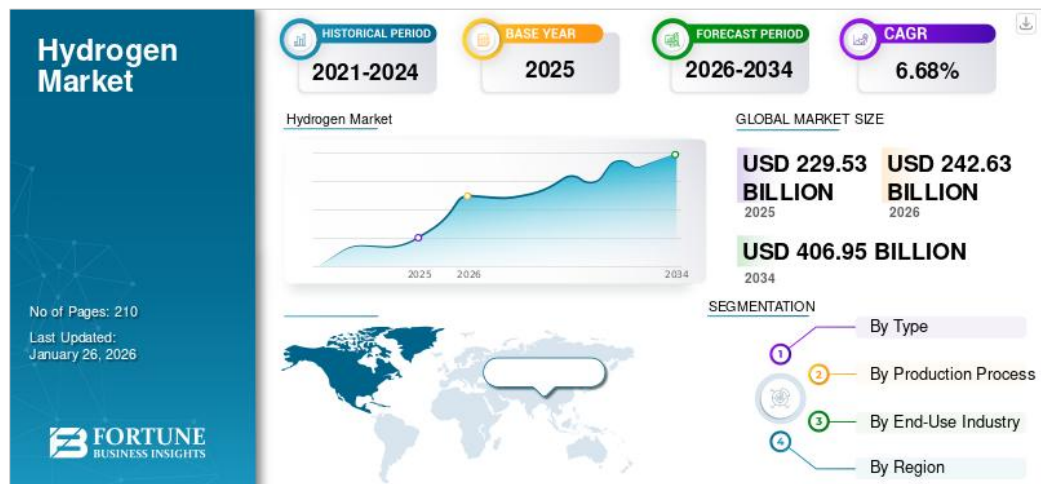
資料來源：Fortune Business Insights，2026年2月

(4) 新能源與環保應用產業

A. 甲烷裂解產氫市場 (Methane Pyrolysis for Hydrogen Production)

近年來全球淨零碳排政策與能源轉型加速推進，其中氫能被視為實現能源轉型與工業減碳的關鍵解決方案之一。根據 Fortune Business Insights 研究，2025 年全球氫能市場規模約為 2,295.3 億美元，預計將由 2026 年的 2,426.3 億美元成長至 2034 年約 4,069.5 億美元，年複合成長率 (CAGR) 約為 6.68% (詳圖 4)。氫能具有高能量密度與低碳排放特性，可廣泛應用於電力發電、能源儲存、交通運輸及工業製程等領域，並被視為支持再生能源整合與推動能源系統去碳化的重要能源載體。鋼鐵、煉油、化工與水泥等高碳排產業正積極導入氫能技術，以降低生產過程中的碳排放並達成淨零排放目標。

(圖4)【全球氫能市場規模與成長趨勢】

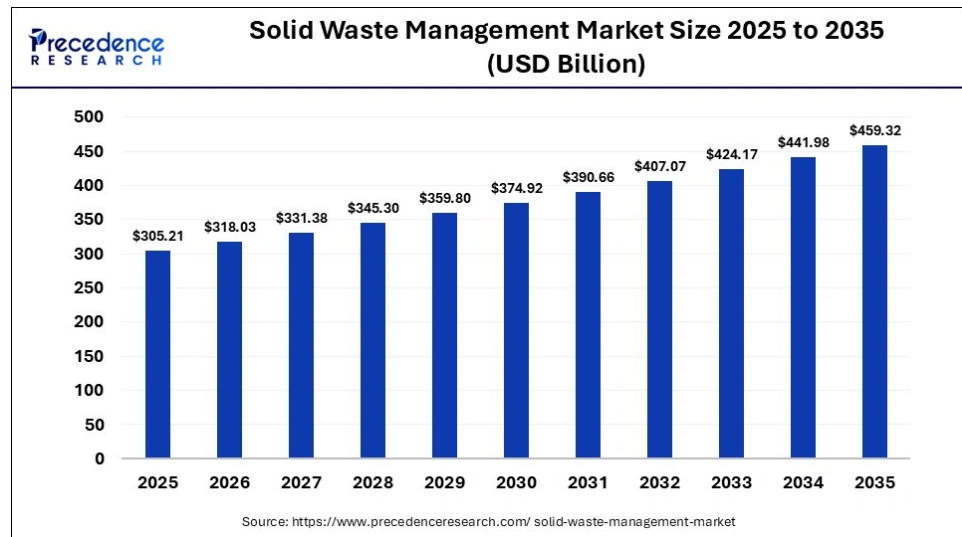


資料來源：Fortune Business Insights，2026年2月

B. 固體廢棄物處理市場 (Solid Waste Management)

根據 Precedence Research 的研究，2025 年全球固體廢棄物管理 (Solid Waste Management) 市場規模約為 3,052 億美元，預計將由 2026 年的 3,180 億美元持續成長至 2035 年約 4,593 億美元，顯示整體產業維持穩定成長趨勢 (詳圖 5)。此一穩健成長趨勢反映出全球對永續發展與資源循環利用的重視日益提高，在城市化與工業化進程加速、人口成長及環境法規日益嚴格的驅動下，各國對於垃圾分類、資源回收及能源回收等有效廢棄物處理方式的需求大幅提升。尤其在亞洲、歐洲與北美地區，智慧型廢棄物管理技術、廢能轉換 (waste-to-energy) 與回收經濟產業快速發展，帶動整體市場規模持續擴張。本公司科技在此領域具備高度應用潛力，其所開發的電漿處理技術可應用於廢棄物的無害化處理，透過高溫電漿將有害廢棄物轉化為無害物質，同時回收可用能源，進一步提升廢棄物處理的效率與環保效益。

(圖5)【全球固體廢棄物管理市場規模與成長】

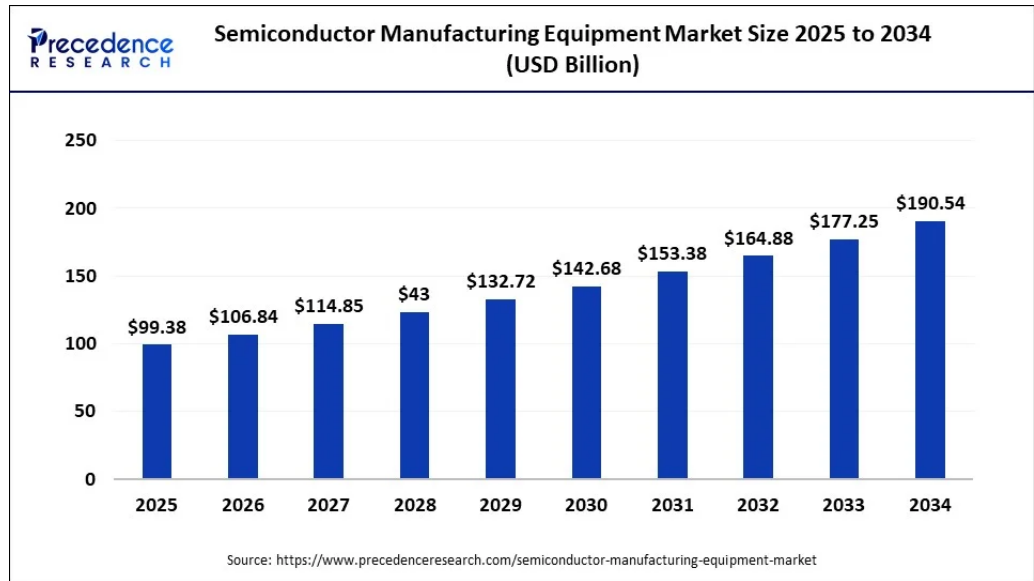


資料來源：Precedence Research，2026年2月

C. 半導體尾氣處理市場 (Semiconductor Exhaust Gas Treatment)

根據 Precedence Research 的研究，2025 年全球半導體製造設備市場規模約為 993.8 億美元，預計將由 2026 年的 1,068.4 億美元持續成長至 2034 年約 1,905.4 億美元，顯示未來十年半導體設備產業將維持長期成長趨勢。(詳圖 6)。這一成長趨勢顯示，儘管產業受景氣循環影響，隨著先進製程、高效能運算 (HPC)、人工智慧 (AI)、車用電子與 5G 等技術持續推進，全球對半導體設備的投資仍持續增加。其中，設備中的尾氣處理技術也日益受到關注，隨著製程節點日益趨細、設備密度提升，如何有效處理製程中產生的有害氣體，不僅關係到產能穩定，更攸關環保法規遵循與工作環境安全。本公司科技所研發的電漿處理設備具備高度應用潛力，可高效分解半導體製程中的有害氣體並轉化為無害物質，進一步提升整體製程的環保效能，呼應全球對永續與綠色製造的重視。

(圖6)【全球半導體設備市場規模預測】



資料來源：Precedence Research，2025年11月

2. 產業上、中、下游之關聯性

區段	定義	內容說明
上游	零組件、材料與模組供應商	<p>包含構成電漿設備所需之關鍵零組件與材料，為本公司設備研製的基礎來源。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●機構部品：真空腔體、機構骨架、加工零件等 ●電控部品：電源模組、電壓調變器、電子與控制單元 ●真空部品：真空泵浦、真空閥件、壓力感測與控制器 ●材料供應：射頻電極、等離子體腔體用高溫陶瓷、石英玻璃、特用合金、表面塗層材料等
中游	電漿設備之設計、整合與製造	<p>本公司自身所屬產業鏈位置，負責將原材料與零組件整合為應用於高階電子製造之設備。涵蓋：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●產品開發與工程設計（真空腔體、射頻模組、氣體混合系統等） ●電漿製程設備製造與模組整合：如真空電漿清洗機、蝕刻機、去膠機、極化設備、分子裂解設備等 ●AI 智慧製程平台開發、客製化設備自動化開發
下游	設備最終應用產業客戶	<p>本公司設備之銷售對象，涵蓋電子與非電子產業的高附加價值應用場域。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●半導體產業：晶圓廠、封裝測試廠（先進封裝、晶圓再生、晶圓表面處理等） ●IC 載板與印刷電路板產業：ABF 載板、BT 載板、HDI 板、伺服器板、軟硬結合板、IC Probe 板等基板製造廠 ●PCB 產業：高密度互連板（HDI）、多層板（MLB）、軟板與特殊應用板等製程設備需求 ●新能源與環保產業：甲烷裂解產氫市場、固體廢棄物處理市場與半導體尾氣處理市場

區段	定義	內容說明
		●其他利基應用：醫療耗材處理、生物感測、汽車零件塑膠件處理、化妝品界面改質等

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

本公司長期專注於電漿表面處理技術及設備開發，其產品橫跨真空電漿與常壓電漿平台，應用於半導體先進封裝、ABF/BT/玻璃載板、印刷電路板、高階顯示器、電動車模組與綠色製程等領域。面對全球製造升級與 ESG 轉型趨勢，公司不僅深耕技術突破與模組化設計，更憑藉差異化的利基策略與在地應變能力，奠定在國際市場的核心競爭地位。

(1) 發展趨勢

A.先進製程驅動電漿製成需求倍增

隨著 FOWLP、CoWoS、Hybrid Bonding、晶圓再生、Chiplet 結構等先進封裝技術逐步導入量產，對乾式表面處理的需求持續上升。本公司產品如 Cu 氧化物去除設備、晶圓清洗蝕刻機、極化處理模組等已具多國客戶導入實績，為下一代先進製程提供關鍵解決方案。

B.ABF 載板/玻璃載板製程轉向乾式與大面積均勻處理

為解決 ABF 材料翹曲與表面殘膠問題，本公司開發全球唯一具備量產能力的 850x750mm 大面積 ABF 乾式蝕刻設備，並將其技術延伸至 FOPLP 與玻璃基板市場，為全球 IC 載板廠提供差異化競爭優勢。

C.綠色製程技術崛起，帶動高溫電漿裂解設備發展

因應淨零碳排與 ESG 要求，公司自研高效電漿火焰處理設備應用於甲烷裂解產氫($\text{CH}_4 \rightarrow \text{C} + 2\text{H}_2$)與 PFC 廢氣分解、醫療/工業廢棄物即時裂解等領域，成為台灣極少數進入環保高溫裂解設備市場的設備商。

D.從「製程機台」走向「解決方案整合服務」

本公司不僅販售單機設備，更透過模組化架構與 AI 製程數據學習平台，協助客戶打造客製化製程參數與自動化流程，強化設備效能與製程良率，實踐「製程即服務 (Process as a Service)」理念。

(2) 競爭情形

A.技術利基定位，避開標準市場競爭

相較於美、日主流大廠聚焦於標準晶圓製程設備，本公司選擇以「高難度、高客製化、非標準應用場景(如 ABF 蝕刻、極化封裝、Cu 鍵合處理)」為定位，成功切入美國一線半導體大廠、日本一線載板廠等一線供應鏈。

B.具 ABF 大面積乾式蝕刻量產實績

在 ABF 載板領域，公司設備已於日系大廠實現穩定量產，並持續擴展至台灣、美國、歐洲客戶。此為極具技術門檻的市場，形成強大先行者優勢。

C. 產品組合涵蓋多產業場景，分散風險並創造交叉成長

本公司產品涵蓋半導體、PCB、顯示器、生醫感測器、新能源與廢氣處理應用，包含電漿蝕刻、電漿極化、乾式去膠、電漿廢氣處理、甲烷裂解等領域，支撐公司營運穩定並創造新興市場動能。

D. 與客戶深度協同研發、專利與 know-how 鎖定核心技術

除布局多項專利（涵蓋模組設計、氣體導流、感應耦合等核心），並以未公開 know-how 作為製程參數核心優勢。設備在導入後可達成與製程聯動的整體優化效果，強化技術綁定力。

E. 在地製造與即時服務為國際廠商無法取代之競爭力

透過自有工廠與在地供應鏈整合，公司可快速應對客戶客製需求並進行升級維護，在亞洲區域特別具備速度與成本優勢。

(三) 技術及研發概況

1. 公司所營業務之技術層次及研究發展

本公司以自有電漿核心技術為基礎，發展具備高度自主性、模組化及跨應用整合能力的電漿設備平台，應用橫跨半導體、IC 載板、印刷電路板、新能源與環保產業，具備極高技術門檻與研發深度。以下為公司技術層次與研究發展重點分析：

(1) 技術層次說明

A. 自主開發電漿製程核心模組平台

本公司所有電漿設備之射頻系統、氣體導流、真空腔體結構、熱控機構與電磁場設計皆為原創開發，非仰賴國外 OEM、ODM 或標準化組裝廠，具備高端技術內涵。並可針對不同應用模組進行拆解與重組，形成具備靈活製程調變能力的整體平台架構。

B. 覆蓋多項應用層級的製程能力

公司技術橫跨真空電漿（清洗、去膠、蝕刻、極化、低溫及高溫分子裂解）、常壓電漿（RF、Arc、Microwave、陣列式等）及高效電漿火焰（methane cracking、廢棄物處理），涵蓋製程包括晶圓再生、先進封裝、載板蝕刻與電漿極化（如 PZT、PVDF 等材料），並進入能源與環保設備（如甲烷裂解、PFC 處理、醫療廢氣處理）等新興技術場域。

C. 模組化與智慧製造能力

a. 建立跨製程模組平台（模組/製程/控制分離設計）。

b. 整合 MES、AI 製程監控與參數自學功能（建置中）。

c. 可依照客戶需求快速開發「製程 + 機台 + 軟體 + 服務」全套解決方案。

(2) 研究發展實績與投入

A.研發投入強度

- a.每年投入約營收 5%為研發費用。
- b.已建置跨領域團隊，整合電漿、材料科學、機構控制、熱流模擬、AI 等領域專業。

B.國際合作與產學研聯盟

與台灣、日本、美國等國研究機構與大學建立產學合作計畫。

C.未來發展方向

發展面向	重點方向說明
技術創新深化	<ul style="list-style-type: none"> ●強化模組化電漿平台技術，提升客製化與應用多元性 ●3D 立體封裝及全乾法電漿解決方案進入量產驗證 ●發展新世代電漿火焰與高溫裂解系統（如氫能應用）
應用領域擴展	<ul style="list-style-type: none"> ●由半導體封裝與 PCB 擴大至綠能、氫能、廢氣與固廢處理等新領域 ●開發適用於 TGV、FOPLP、Hybrid Bonding 等關鍵製程
ESG技術布局	<ul style="list-style-type: none"> ●投入低碳電漿乾式製程開發，替代傳統濕製程 ●建構具備節能減碳與高效環保的解決方案（如氫能生產、尾氣分解）
國際市場擴張	<ul style="list-style-type: none"> ●強化與日、美、台一線晶圓廠、PCB 大廠協同開發 ●強化在地客戶需求整合，拓展海外據點
專利與智財保障	<ul style="list-style-type: none"> ●強化自主研發成果專利佈局，聚焦機構設計、電漿腔體、控制軟體等模組化設計 ●延伸專利應用至氫能與環保裝置
研發機制強化	<ul style="list-style-type: none"> ●每年投入營收 5%以上於 R&D ●採用安索夫矩陣進行新產品/新市場發展，推動產品平台化與模組升級

2.研究發展人員與其學經歷

單位：人

學歷		113 年度		114 年度		115 年 3 月 31 日	
		人數	比重(%)	人數	比重(%)	人數	比重(%)
學歷分布	博士	2	22.22	2	20.00	2	20.00
	碩士	5	55.56	6	60.00	6	60.00
	學士	2	22.22	2	20.00	2	20.00
	合計	9	100.00	10	100.00	10	100.00
平均年資(年)		6.08		6.06		6.31	

3.最近兩年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品

(1) 最近兩年度投入研發費用情形

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度
研發費用		23,958	27,137
營業收入淨額		547,630	518,437
研發費用占營業收入淨額比率(%)		4.37	5.23

註：113 及 114 年度為合併財務報表數字。

(2) 開發成功之技術或產品

年度	產品
108	◆ 用於廢棄物處理之直流電漿火炬設備
109	◆ 晶圓背面高分子殘留物去除之大氣電漿設備 ◆ 用於非等向性乾式蝕刻製程之感應式高密度電漿-反應性離子蝕刻設備
110	◆ 用於金屬氧化物去除之微波大氣電漿設備
111	◆ 用於甲烷裂解產氫之電弧式大氣電漿設備 ◆ 用於甲烷轉化之介電質放電式大氣電漿設備
112	◆ 寬幅型金屬氧化物去除之微波大氣電漿設備 ◆ 用於甲烷裂解產氫之微波電漿火炬設備
113	◆ 大面積陣列式微波電漿系統

(四) 長、短期業務發展計畫

1.短期發展計畫

- (1) 5G 通訊產業鏈電漿應用及市場開發
- (2) 連續式電漿設備硬體與軟體之推廣
- (3) 高效能電漿蝕刻應用之開發(半導體、IC 載板、先進封裝、Micro-LED)
- (4) 離子束蝕刻技術之開發(光學級拋光、CPO 應用)
- (5) 因應電子產業 ESG 的殷切需求，全力開發全乾法電漿製程，解決濕製程、耗能製程在微細線路製程上的瓶頸及環境衝擊問題
- (6) 針對歐美日上游龍頭或系統大廠，進行重點式的合作

2.長期發展計畫

- (1) 開發歐美、東南亞 PCB 及半導體後段市場應用，並加強應用廣度。
- (2) 節能減碳新能源、空氣汙染防制(以工業用為主)之市場調查與開發。
- (3) 利用電漿環保、低能耗的技術特性，提供減碳及永續經營的製程方案。
- (4) 提高產品品質並強化售後服務，在經營上持續秉持永續經營的理念，建立企業優良文化，並積極參與公益活動，重視社會責任。
- (5) 掌握市場動向，擴大市場規模以開拓全球性電漿市場，並建立全球性之領導品牌。
- (6) 配合 5G、AI 高速網路及 VR/AR 應用等趨勢崛起，利用本公司專業技術結合其他專業領域，持續投入研發，並積極開發各項有利基之新產品，使產品多元化拓展更多市場應用。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元；%

地區 \ 年度	113 年度		114 年度	
	金額	%	金額	%
台灣	261,590	47.77	289,969	55.93
中國大陸	236,825	43.25	156,141	30.12
美國	2,176	0.40	10,136	1.96
奧地利	23,681	4.32	15,587	3.00
其他	23,358	4.26	46,604	8.99
合計	547,630	100.00	518,437	100.00

2. 市場占有率

本公司為生產各式電漿設備之專業廠商，主要應用於半導體、PCB 及光電等電子產業，目前國內的競爭者有友威科、鈦昇及天虹等，國外則是有韓商第四紀(JS)、美商 March 及日商 Nissin、中國商寶丰堂。依 2026 年 3 月台經院產經資料庫之年度產業報告，2025 年全球半導體設備(含半導體、印刷電路板、平面顯示器及其他電子生產設備)之銷售值已突破 1,330 億美元(約台幣 41,802 億元)，而台灣市場設備銷售額為 210 億美元(約台幣 6,600 億元)。本公司在全球與台灣半導體設備市占率分別約為 0.012%與 0.079%，整體而言仍有極大的成長空間。

3. 市場未來之供需狀況及成長性

根據台經院資料預測，2026 年我國半導體設備業產業的產值可達 245 億美元(約台幣 7,700 億元)，年增率達 5.56%，且台廠積極投入 2nm 先進封裝、AI 伺服器、電動車、低軌衛星等新興應用布局效益逐步顯現，但因應地緣政治因素，台廠陸續前進全世界建置產能，在新產能陸續加入下，有助於推升 2026 年產值表現並提高產業資本支出。在全球半導體業資本支出增加下，同時我國產業之國際競爭力提升，將帶動 2026 年我國半導體設備銷售成長，公司應該可同步受惠。

而以 IC 載板為主的 PCB 產業，由於持續面臨線路精細化、堆疊層數增多且更複雜、環保議題等挑戰，選用奈米級處理的乾式且乾淨之電漿蝕刻，愈來愈有其必要性。且隨著 5G、AI 高速網路、虛擬實境等應用對於精密 IC 的需求日益增高，本公司針對先進封裝等半導體電漿蝕刻應用所開發的高速蝕刻機，於本司各式機台銷售的比重占比也會逐漸提升。本公司多年來鑽研高蝕刻率、高均勻度的電漿處理技術，且於機台整合及生產監控連線，有豐富的經驗，進而有效提升生產良率，提高客戶的生產效率與品質，促使客戶能創造更高的產品附加價值，增加本身產品在市場上的優勢，使其更具競爭力。

4. 競爭利基

(1) 研發團隊完整且經驗豐富

本公司目前經營及技術團隊在電漿技術領域已有 20 年以上之產業經驗，對產業環境變化、產品發展趨勢、生產製造及行銷業務等各方面具嫻熟經驗，可迅速掌握市場趨勢脈動，並充份了解產品製程所需面對之問題，即時提供客戶專業完善之服務，對本公司現有產品推廣、新產品開發具有相當助益。

(2) 自有先進電漿技術與專利

本公司以自主開發各式尖端電漿技術，提供業界各項先進電漿設備與解決方案為主要營運方針，各專屬領域之研發人才皆持續擴充團隊研發量能，且針對各式電漿技術，本公司持續地取得相關專利與認證，以確保本公司電漿設備與技術領先業界，避免成熟領域削價競爭。目前本公司取得之專利，係以高密度真空電漿與常壓電漿技術為主。

(3) 市場進入門檻高，供應鏈競爭居領先地位

本公司亦會積極針對產業鏈的上游歐美或日本著名品牌客戶，進行電漿技術討論、測試、合作與認證，以確保本公司在該產業鏈的銷售地位；此外，本公司會針對客戶的現時或未來需求，取得設備的各式安規、環保、電氣法規認證，以提高競爭者的進入障礙。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 產品微細化

電漿解決方案為微米級，乃至於奈米級的乾式環保處理方式，隨著電子產品日趨精細，傳統濕式(酸液或鹼液)處理方式已逐漸無法因應，以印刷電路板產業為例，盲埋孔孔徑日漸縮小，酸液或鹼液進入孔內難度增高，因而無法完全將孔內膠渣清除乾淨。電漿係採用原子級的離子或自由基來進行膠渣的處理，因此電漿製程可以處理極小孔徑，引進電漿製程有其必要性。本公司藉著研發新式電漿技術，並進行電漿參數的優化，以增加電漿製程的重要性與絕對性。

B. ESG 節能減碳目標，環保要求日益嚴格

隨著各國政府日趨嚴格的環保政策，傳統濕式處理方式面臨廢液處理、化學品大量消耗、高能耗、佔地及人力需求大的不良因素，乾淨的乾式電漿處理方式可提供更環保的解決方案。本公司仍會持續地朝著降低電漿運作成本，提供更乾淨電漿處理方式的目標前進。

C. 工業 4.0 及生產監控需求

全球企業和供應鏈因應產品精細化避免污染特性、生產有效管理、節能減碳及降低人力等需求，客戶逐漸重視工業 4.0 及生產監控的引進。本公司 10 多年前已進行生產監控標準的軟、硬體開發，可望迅速地滿足客戶關於生產監控的需求，並提高新的競爭者的跨入門檻。

(2) 不利因素

A. 區域競爭者削價競爭

隨著新的區域競爭者(如中國大陸的競爭者)參與競爭，削價取得訂單的狀況將日趨嚴重。

因應對策：

開發新式機種與技術，以擺脫成熟機台之競爭；取得技術及機台之專利，以阻擋新的競爭者進入；取得各式安規及領導客戶的認證，以提高競爭者的跨入門檻。

B. 營運狀況受客戶產業景氣循環影響

本公司主要營收來自於電子業，由於電子業景氣循環週期短，變動劇烈，單一產業受到景氣循環的影響很大，因此客戶之營運起伏，可能衝擊本公司來自於該產業的營收數字。

因應對策：

不斷地發展各式先進電漿技術，掌握業界需求與應用，將核心電漿技術及解決方案，領先同業，應用於半導體、IC載板、PCB、光電等各個主要電子領域製程，除了強化本公司的競爭力外，也避免單一產業因為景氣起伏，帶來本公司營收的重大衝擊；此外，藉由管控成本與庫存、提升供應系統反應速度、開發新式應用與設備，來降低對本公司營收與獲利的影響。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品用途

產品項目	重要用途
電漿清洗機	電子或非電子元件表面乾式清潔與改質，可適用於各式半導體、印刷電路板、光電、SMT、生醫、塑膠、車用部品等製程
電漿蝕刻機	高分子或金屬材料表面進行乾式蝕刻，以應用於半導體、先進封裝、IC載板、Micro-LED等製程
電漿極化機	電漿針對壓電材料進行極化處理，以應用於屏下指紋辨識 Sensor、散熱裝置、運動 Sensor、健康相關監控 Sensor 製作之製程
電漿表面處理機	針對各式電子或非電子產品，進行表面性質的改變(例如親水性提升、粗糙度改善)，以利後製程之良率提升(例如改善鍍膜或印刷品質、貼合拉力提升等)

2. 主要產品產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

原料名稱	供應情形
電源供應器	良好
真空幫浦	良好
機構件	良好
流量計	良好
真空元件	良好

(四) 最近兩年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

1.最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化說明

產品別 項目/年度	電漿設備		維修	
	113 年度	114 年度	113 年度	114 年度
銷貨收入淨額	493,569	439,828	54,061	78,622
銷貨毛利	191,687	202,418	23,253	30,305
毛利率	38.84	46.02	43.01	38.55
毛利率變動率	18.48		-10.37	

2.毛利率變動達 20%以上之說明：無。

(五) 主要進銷貨供應商與客戶名單

1.最近二年度任一年度中占進貨總額百分之十以上之進貨供應商客戶名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

附表十六之一 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係
1	B1	27,743	12.94	無	B2	34,784	14.10	無
2	B2	24,485	11.43	無	B1	32,240	13.07	無
-	其他	162,096	75.63	無	其他	179,718	72.83	無
	進貨淨額	214,324	100.00		進貨淨額	246,742	100.00	

增減變動說明：

主係因銷售產品別組合差異，致使本公司向供應商採購金額產生變動，公司目前與供應商及委外加工廠商維持良好關係。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

附表十六之二 最近二年度主要主要銷貨客戶資料 單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A1	78,619	14.36	無	A1	32,003	6.17	無
2	A2	65,425	11.94	無	A4	835	0.16	無
-	其他	403,586	73.70		其他	485,599	93.67	
	銷貨淨額	547,630	100.00		銷貨淨額	518,437	100.00	

增減變動說明：主要係因為客戶組織調整與客戶下單的變化不同導致。

三、從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

附表十九 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		113年度	114年度	115年截至3月31日止
員工人數 (人)	直接員工	24	34	33
	間接員工	43	48	47
	合計	67	82	80
平均年歲(歲)		40.63	40.53	40.67
平均服務年資(年)		8.56	7.49	7.70
學歷分佈比率 (%)	博士	4.48	4.88	5.00
	碩士	23.88	24.39	23.75
	大學(專)	67.16	67.07	67.50
	高中/職	4.48	3.66	3.75

四、環保支出資訊

- (一) 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形說明
- (二) 本公司主要從事電漿設備之組裝及維修等業務，過程中並無特殊污染產生，毋須申請污染設施設置許可證或污染排放許可證，亦毋須繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員。
- (三) 列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
- (四) 說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
- (五) 說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。
- (六) 說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

五、勞資關係

(一) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施、進修及訓練與其實施狀況

本公司一向關心及重視員工福利，依中華民國勞動基準法相關規定辦理勞工保險、全民健康及提撥退休金，並視公司營運成果辦理年終獎金發放、調薪。此外，依法提撥福利金，成立職工福利委員會，員工享有端午、中秋節獎金、定期免費員工健康檢查、團體保險、尾牙、不定期舉辦員工旅遊、婚喪喜慶補助金等。

為提升員工專業技術能力、加強工作效率及對產品品質重視，配合政府企業人力資源提升計畫，依年度教育訓練計畫表執行教育訓練，以強化各機能別員工專業能力。

2. 退休制度與其實施狀況

A. 本國員工：本公司依據勞工退休金條例(勞退新制)之退休金制度，依員工每月薪資提撥百分之六退休金至勞工保險局個人之退休金專戶，本公司於 114 及 113 年度依照確定提撥計畫中明定比例應提撥之金額已於綜

合損益表認列費用總額分別為 3,598 仟元及 3,330 仟元。勞工達退休條件時得自行向主管機關提出申請領取該筆退休金，本公司員工退休辦法悉依勞動基準法及其相關法規訂定，依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

B. 外籍員工：依勞動基準法有關規定辦理(舊制)，每月提撥退休金入台灣銀行專戶；員工退休金之支付，係根據服務年資所獲得之基數及其退休時前六個月之平均薪資計算。基數之計算係每位員工前十五年之服務，每服務滿一年可獲得二個基數，自第十六年起，每服務滿一年可獲得一個基數，最高以四十五個基數為限。

3. 勞資間之協議情形與員工權益維護措施

本公司相當重視內部溝通，除定期召開勞資會議外，公司內部尚有各種溝通管道，管理階層與員工均互相尊重，並提供意見改善，為公司成長而共同努力。截至目前為止，勞資關係和諧互信且互動良好。

本公司依據相關法令規定，訂定勞資雙方聘僱合約、工作規則及各項管理規章，內容明訂員工權利義務及福利項目，以維護所有員工權益。

(二) 說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

1. 資通安全風險管理架構

本公司由總經理直接督導資訊安全，包含全公司之電腦設備安全管理、網路安全管理、防火牆管理及電腦病毒與惡意軟體之防範。

2. 資通安全政策

本公司制定電腦化資訊作業內控制度，內容包括系統分工與權限及資料備份備援與維護方式，使公司員工有所遵循。稽核人員每年依據內控規定對相關作業進行稽查，評估對各項風險控制及異常事項之規定是否確實執行，以降低相關資安風險。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

防火牆等網路系統安全皆由資訊人員即時更新維護及監控，並每年對同仁進行資安宣導，加強同仁相關資安危機意識，另定有災難復原計畫書，由資訊人員每年定期執行測試一次，確保計畫書內容符合當前環境與需求。

(二) 列明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授信合約	國泰世華	111.02.20-126.02.20	長期擔保借款	土地及廠房抵押擔保
授信合約	國泰世華	111.02.20-126.02.20	長期擔保借款	土地及廠房抵押擔保
授信合約	國泰世華	109.10.12-126.02.20	長期擔保借款	土地及廠房抵押擔保
授信合約	國泰世華	110.02.01-114.10.12	中期擔保借款	土地及廠房抵押擔保
授信合約	永豐銀行	114.06.30-115.06.30	短期擔保借款(週轉金)	依債務餘額徵十足定存單設質擔保
授信合約	元大銀行	114.12.01-115.12.01	短期擔保借款(週轉金)	提供美元定期存單擔保
授信合約	元大銀行	114.12.01-115.12.01	衍生性金融商品(避險額度)美元參拾萬元	-

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一) 財務狀況比較分析表-合併

單位：新台幣仟元

項目	年度	113年度	114年度	差異	
				金額	變動比例%
流動資產		793,825	997,348	203,523	25.64
不動產、廠房及設備		266,746	265,111	(1,635)	(0.61)
無形資產		2,036	1,245	(791)	(38.85)
其他資產		24,532	24,651	119	0.49
資產總額		1,087,139	1,288,355	201,216	18.51
流動負債		184,548	185,452	904	0.49
非流動負債		156,539	110,576	(45,963)	(29.36)
負債總額		341,087	296,028	(45,059)	(13.21)
股本		288,598	367,968	79,370	27.50
資本公積		55,390	248,516	193,126	348.67
保留盈餘		402,047	375,862	(26,185)	(6.51)
其他權益		17	(19)	(36)	(211.76)
權益總額		746,052	992,327	246,275	33.01

重要變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)主要原因及其影響分析如下：

1. 流動資產增加主要係因為現金增資導致現金與約當現金及其他金融資產-流動分別增加約 77,907 仟元及 59,320 仟元，且因為 114 年度第四季業績較去年增加導致應收帳款增加約 55,155 仟元所致。
2. 非流動負債減少 45,963 仟元，主要係因為低率借款之優惠期限到期，公司償還借款所致。
3. 股本與資本公積增加 79,370 仟元與 193,126 仟元，主要係因為本年度公司上市現金增資、公司持續獲利，且發放股票股利所致。
4. 權益總額增加 246,275 仟元，主要係因為現金增資且公司持續獲利所致。

註：年度財務資料均經會計師查核簽證。

(二) 財務狀況比較分析表-個體

單位：新台幣仟元

項目	年度	113年度	114年度	差異	
				金額	變動比例%
流動資產		781,682	987,877	206,195	26.38
採用權益法之投資		6,212	5,010	(1,202)	(19.35)
不動產、廠房及設備		266,698	264,970	(1,728)	(0.65)
無形資產		2,036	1,245	(791)	(38.85)
其他資產		24,288	23,163	(1,125)	(4.63)
資產總額		1,080,916	1,282,265	201,349	18.63
流動負債		178,325	179,362	1,037	0.58
非流動負債		156,539	110,576	(45,963)	(29.36)
負債總額		334,864	289,938	(44,926)	(13.42)
股本		288,598	367,968	79,370	27.50
資本公積		55,390	248,516	193,126	348.67
保留盈餘		402,047	375,862	(26,185)	(6.51)
其他權益		17	(19)	(36)	(211.76)
權益總額		746,052	992,327	246,275	33.01

重要變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上,且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)主要原因及其影響分析如下:

1. 流動資產增加主要係因為現金增資導致現金與約當現金及其他金融資產-流動分別增加約 82,755 仟元及 59,320 仟元,且因為 114 年度第四季業績較去年增加導致應收帳款增加約 55,309 仟元所致。
2. 非流動負債減少 45,963 仟元,主要係因為低率借款之優惠期限到期,公司償還借款所致。
3. 股本與資本公積增加 79,370 仟元與 193,126 仟元,主要係因為本年度公司上市現金增資、公司持續獲利,且發放股票股利所致。
4. 權益總額增加 246,275 仟元,主要係因為現金增資且公司持續獲利所致。

註：年度財務資料均經會計師查核簽證。

二、財務績效

(一) 經營結果比較分析表-合併

單位：新台幣仟元

項目	年度	113年	114年	差異	
				金額	%
營業收入		547,630	518,437	(29,193)	(5.33)
營業成本		332,690	285,714	(46,976)	(14.12)
營業毛利		214,940	232,723	17,783	8.27
營業費用		127,901	158,697	30,796	24.08
營業利益		87,039	74,026	(13,013)	(14.95)
營業外收入及支出		25,944	1,601	(24,343)	(93.83)
稅前淨利		112,983	75,627	(37,356)	(33.06)
所得稅費用		26,033	15,232	(10,801)	(41.49)
本期淨利		86,950	60,395	(26,555)	(30.54)
本年度綜合損益總額		87,085	60,359	(26,726)	(30.69)
重要變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下：					
1. 營業費用增加30,796仟元，主係因公司擴大規模人數增加，且員工認購新股所致。					
2. 營業外收入及支出本期減少24,343仟元，主係上半年匯率波動劇烈影響所致。					
3. 稅前淨利、所得稅費用、本期淨利及本年度綜合損益總額減少，主係本年度雖營業收入較去年減少，但因轉型高毛利機台導致毛利增加，然因擴大規模導致營業費用增加，且營業外支出因匯率波動增加，導致獲利不如預期所致。					

註：年度財務資料均經會計師查核簽證。

(二) 經營結果比較分析表-個體

單位：新台幣仟元

項目	年度	113年	114年	差異	
				金額	%
營業收入		546,155	517,247	(28,908)	(5.29)
營業成本		336,907	287,877	(49,030)	(14.55)
營業毛利		209,248	229,370	20,122	9.62
營業費用		123,158	154,330	31,172	25.31
營業利益		86,090	75,040	(11,050)	(12.84)
營業外收入及支出		26,748	519	(26,229)	(98.06)
稅前淨利		112,838	75,559	(37,279)	(33.04)
所得稅費用		25,888	15,164	(10,724)	(41.42)
本期淨利		86,950	60,395	(26,555)	(30.54)
本年度綜合損益總額		87,085	60,359	(26,726)	(30.69)
重要變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下：					
1. 營業費用增加31,172仟元，主係因公司擴大規模人數增加，且員工認購新股所致。					
2. 營業外收入及支出本期減少26,229仟元，主係上半年匯率波動劇烈影響所致。					
3. 稅前淨利、所得稅費用、本期淨利及本年度綜合損益總額減少，主係本年度營業收入較去年減少，雖轉型高毛利機台導致毛利增加，然因擴大規模導致營業費用增加，且營業外支出因匯率波動增加所致。					

註：年度財務資料均經會計師查核簽證。

(三) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司參酌總體經濟環境變化、產業景氣循環、本公司經營策略及研究發展，並隨時掌握市場脈絡動向，上述之財務狀況與財務績效變動對本公司並無重大不利影響，且公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

1. 最近年度(114)現金流量變動之分析說明-合併

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年度	114 年度	變動金額	變動比例
營業活動	172,288	4,031	(168,257)	(97.66)
投資活動	(23,739)	(62,604)	(38,865)	(163.72)
融資活動	(68,755)	136,516	205,271	(298.55)

現金流量變動情形分析：
1. 營業活動：114 年淨流入較去年減少，主係稅前淨利減少約 37,356 千元，以及存貨、應收款項、預付款項、應付款項及其他應付款等變動之綜合影響，皆屬正常營運之現金流量。
2. 投資活動：114 年淨流出較去年增加，主要因為將資金轉定期存款增加所致。
3. 融資活動：114 年為現金淨流入，主係本年度現金增資所致。

2. 最近年度(114)現金流量變動之分析說明-個體

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年度	114 年度	變動金額	變動比例
營業活動	173,120	7,477	(165,643)	(95.68)
投資活動	(29,060)	(61,238)	(32,178)	(110.73)
融資活動	(68,755)	136,516	205,271	298.55

現金流量變動情形分析：
1. 營業活動：114 年淨流入較去年減少，主係稅前淨利減少約 37,297 千元，以及存貨、應收款項、預付款項、應付款項及其他應付款等變動之綜合影響，皆屬正常營運之現金流量。
2. 投資活動：114 年淨流出較去年增加，主要因為將資金轉定期存款增加所致。
3. 融資活動：114 年為現金淨流入，主係本年度現金增資所致。

(二) 流動性不足之改善計畫

本公司之 114 年度與 113 年度流動資產均大於流動負債，且 114 及 113 年度營業活動皆為淨現金流入，並無流動性不足之情事。

(三) 未來一年現金流動性分析

1. 未來一年(115)現金流動性分析-合併

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	全年來自營業 活動淨現金流 量(2)	全年來自投 資活動淨現 金流量(3)	全年來自籌 資活動淨現 金流量(4)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)+(4)	現金不足額之 補救措施	
					投資計畫	理財計畫
543,381	(44,853)	(24,154)	(58,121)	416,253	-	-

現金流量變動情形分析：
 1. 營業活動：因預計 115 年度主要訂單在下半年度，而公司備料與增加人工與相應產能，致營業活動淨現金流出。
 2. 投資活動：主係預計研發設備研究開發投入計畫，致投資活動淨現金流出。
 3. 籌資活動：主係償還一年內到期長期負債與現金股利發放增加現金流出。

2. 未來一年(115)現金流動性分析-個體

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	全年來自營業 活動淨現金流 量(2)	全年來自投 資活動淨現 金流量(3)	全年來自籌 資活動淨現 金流量(4)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)+(4)	現金不足額之 補救措施	
					投資計畫	理財計畫
541,613	(43,983)	(24,154)	(58,121)	415,355	-	-

現金流量變動情形分析：
 1. 營業活動：因預計 115 年度主要訂單在下半年度，而公司備料與增加人工與相應產能，致營業活動淨現金流出。
 2. 投資活動：主係預計研發設備研究開發投入計畫，致投資活動淨現金流出。
 3. 籌資活動：主係償還一年內到期長期負債與現金股利發放增加現金流出。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 轉投資政策

本公司轉投資政策係基於永續經營及營運成長性考量，對本業發展或拓展業務範圍有利之事業，並訂有「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」，為公司進行轉投資事業之依據，以掌握相關財務業務狀況。

(二) 獲利或虧損之主要原因及改善計畫：子孫公司皆已併入合併報表。

單位：新台幣仟元/外幣仟元

轉投資事業	主要 營業	投資 成本	帳面 價值	投資 損益	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫
STABLE PROMISE GROUP CO., LTD.	一般投資業	USD 500	5,010	(1,166)	主因 100%轉投資昆 山金暉盛獲利所致	針對金暉盛進 行成本控管計 畫
昆山金暉盛電子商 貿有限公司	電子零組件 貿易與售後 服務	RMB 3,318	5,010	(1,166)	主因昆山金暉盛人 力與成本進行控管 所致。	持續控管人力 報工時數、執 行成本管制措 施

註：本公司係透過 STABLE PROMISE Group CO., LTD.投資昆山金暉盛電子商貿有限公司。

(三) 未來一年投資計畫

因 113 年擬投資相關設備以昆山金暉盛辦公室裝修後，其效應會逐步顯現，故預計 115 年度到 116 年暫時不會增加子公司之投資。本公司長期之轉投資政策，係以保守穩健為原則，並配合公司長期發展策略進行本業相關之投資佈局。公司將持續監督管理既有之轉投資公司，以達成預期之轉投資目標，強化整體投資績效。

六、風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動

(1) 對損益之影響

本公司 114 年度及 113 年度利息收入分別為 5,019 仟元及 4,112 仟元，佔本公司稅前純益 6.64% 及 3.64%，另本公司 114 年度及 113 年度利息支出分別為 3,157 仟元及 3,300 仟元，佔本公司稅前純益約 4.17% 及 2.92%，其中利息費用主要係公司購買土地與建廠向銀行借款之利息，本公司會以銀行往來配合狀況及利率走勢評估，以取得較低資金成本為考量，114 年度及截至公開說明書刊印日止之利率變動對本公司損益之影響尚屬有限。

(2) 未來因應措施

本公司財務結構良好，自有資金尚稱充裕，財務規劃以保守穩健為原則，資金調度首重安全之管理，本公司未來將因應公司規劃發展及視當下金融市場利率變動適時調整資金運用，以降低利率變化對本公司損益產生之影響。

2. 匯率變動

(1) 對損益之影響

本公司外銷與內銷比重約為 50:50，主要以美金計價，貨款收取後多保守承作外幣定存，並無從事任何投機及套利之外匯操作。114 年度及 113 年度淨外幣兌換(損)益分別為利益(8,260)仟元及 22,349 仟元。114 年產生之兌換損失主係因當年度上半年外幣匯率波動大且快，導致在第二季承受相當程度的兌換損失，然而隨著下半年度匯率波動逐漸穩定，且公司採取相應之措施，故在期末依外幣匯率波動評價時匯兌損失明顯縮小。隨著未來公司在外幣貨款的收取，外幣部位的平均成本將逐漸降低，114 年度及截至公開說明書刊印日止，對本公司尚無重大影響，同時公司也將視適當時機調整外幣部位。

(2) 未來因應措施

- A. 由專人負責定時諮詢各專業銀行的匯率變化資訊，以充分掌握匯率走勢。
- B. 與主要往來銀行開立外匯存款帳戶，客戶匯入之貨款則視實際資金需求及匯率可能變動趨勢，適時決定遠匯交易、外幣兌換或存入外匯存款帳戶。

3. 通貨膨脹影響

本公司 114 年度及截至年報刊印日止的損益情況，尚無因通貨膨脹而產生重大影響，預測通貨膨脹對本公司損益之影響尚屬有限。未來本公司仍將持續注意通貨膨脹

是否影響成本之情形，必要時採取適當的調整售價及穩定成本措施，以降低對公司營運之影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司一向秉持專注本業及務實原則經營事業，財務政策以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿之投資業務。本公司已訂定「資金貸與及背書保證處理程序」及「取得或處分資產處理程序」等辦法，以適用於本公司之遵循依據。本公司 114 年度及截至公開說明書刊印日止，並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及衍生性商品交易之情事。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1. 未來研發計畫

項目	計畫名稱	用途
Hybrid Bonding 表面活化設備	銅金屬表面活化電漿應用開發	透過在原子層級直接連接兩片晶元或晶片的銅金屬與絕緣介電質。
大面積大氣電漿噴頭開發	中頻寬幅電漿頭開發	去除銅腳表面氧化物，提高銅-銅直接接合之可靠度
ABF 蝕刻	ICP-RIE ABF 蝕刻機開發	取代載板之雷射鑽孔製程
Underfill 前清潔	高密度微波電漿機台開發	消除 underfill 灌膠之空孔缺陷
ICP-RIE 電極建置	高密度感應耦合電漿離子蝕刻精密加工開發	強化高蝕刻速率、低損傷、提選擇比與優異的意向性加工能力

2. 預計投入之研發費用

本公司及子公司預計於 115 年度投入研發費用約新台幣 24,154 仟元，主要係依新產品及新技術開發計畫編列，如 Hbrid Bonding 表面活化設備、Underfil 前間隙清潔活化設備等等。未來視市場需求、營運狀況、技術開發狀況及功能性產品推出規劃，逐步增加研發經費的投入，以確保公司核心競爭力

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司營運均遵循國內外相關法令，採取適當經營方針，同時開發符合產業之新技術及產品，以擴展市場版圖，且本公司之管理階層亦隨時注意國內外重要政策發展及法規變動等相關趨勢與資訊，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策，適時調整本公司營運策略。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未受到國內外之重要政策及法律變動，而對本公司財務及業務有重大影響情事。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

因應科技改變及產業變化，公司聘僱市場優秀人才，加強公司研發實力，同時亦持續投入策略性相關新技術的研究，順應科技及市場需求的變化，具有即時研發新技術及產品的能力，轉化關鍵性技術運用在各項優勢產品上，維持產業競爭力。

最近年度及截至年報刊印日止，並無重大之科技改變(包括資通安全風險)及產業變化，其結果足使本公司及子公司財務業務產生重大影響之情事。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司係以誠信及穩健為經營原則，自成立以來一切依法行事，遵守相關法令規範，以技術、品質與服務建立起良好企業品牌及形象，同時強化內部溝通與管理，保持和諧之勞資關係，持續維持優良的企業形象。本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無任何影響企業形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無進行併購之計畫。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無進行擴充廠房之計畫。

(九) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無股權大量移轉或更換之情事。

(十) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有經營權改變之情事。

(十一) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十二) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業概況

1. 關係企業組織圖(截至 114 年 12 月 31 日)



2. 依公司法第 369 條之 3 推定有控制與從屬關係公司：無

3. 各關係企業基本資料

單位：仟元/114 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Stable Promise Group Co., Ltd.	99/6/11	No. 4, Franky Building, Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles.	15,178 (USD 500)	一般投資業
昆山金暉盛電子商貿有限公司(註)	99/12/24	江蘇省昆山開發區常發香城名園 19 號樓 305 室	15,178 (RMB 3,318)	電子零組件貿易與售後服務。

註：本公司係透過第三地區公司再投資大陸。

4. 推定關係者相同股東資料：無。

5. 整體關係企業經營所涵蓋之行業：

本公司暨集團各公司為專業提供電漿設備與服務廠商，關係企業經營業務所涵蓋的行業，包括為電漿設備製造與維修服務、與電漿相關零組件買賣等業務，集團公司僅母公司提供電漿設備製造，子公司金暉盛則是提供技術與後續服務、電漿設備零組件買賣。集團公司之目的在透過投資控股、技術、產能、行銷及服務的互相支援，創造最大綜效，滿足客戶全方位的需求。

6. 各關係企業董監事、總經理資料

單位：仟股/114 年 12 月 31 日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Stable Promise Group Co., Ltd.	董事長	本公司科技股份有限公司 代表人：宋俊毅	500	100%
昆山金暉盛電子商貿有限公司	董事長	Stable Promise Group Co., Ltd.	—	100%

(二) 關係企業合併營業報告書

單位：仟元/114年12月31日

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	被投資公司 本期(損)益	本期認列之 投資(損)益
Stable Promise Group Co., Ltd.	USD 500	USD 159	USD -	USD 159	USD -37	USD -37
昆山金暉盛電 子商貿有限公 司	RMB 3,320	RMB 3,794	RMB 2,679	RMB 1,115	RMB -270	RMB -270

(三) 關係企業合併財務報告


本公司民國 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司，與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

(四) 關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無

暉盛科技股份有限公司

董事長:宋俊毅

